

**2024-09-05 Qualcomm Daily Media Scan**

高通推全新8核Snapdragon X Plus平台 專為Copilot＋ PC使用者設計

2024-09-04 / 工商時報 / 張珈睿

<https://www.ctee.com.tw/news/20240904701875-430502>

高通於2024年柏林消費性電子展（IFA 2024）推出全新8核Snapdragon X Plus平台，進一步鞏固其在輕薄型PC市場中的領先地位。8核Snapdragon X Plus平台與同類產品相比，CPU效能提升高達61％，而功耗則比競爭對手低179％，能在維持高效能的同時，提供長達數日的電池續航力；其強大的GPU可支援多達三台外部顯示器。亦配備了45 TOPS的強大NPU核心，透過先進的AI性能，使用者可以在裝置上體驗到更為智能、直觀的Copilot＋功能。 高通總裁暨執行長Cristiano Amon提到：「我們透過8核Snapdragon X Plus，將這一變革性的AI體驗和卓越效能帶給更多使用者。」目前，搭載8核Snapdragon X Plus平台的部分PC產品已經上市。8核Snapdragon X Plus平台專為700至900美元價位區間的Copilot＋ PC而設計，約合新台幣2.25萬至2.9萬元，與消費型平價筆電相當，業界解讀這意味著高通將大打平價AI PC戰，將引動新一波市場競爭。

Qualcomm launches new 8-Core Snapdragon X Plus Platform designed for Copilot + PC users

Qualcomm unveiled its new 8-core Snapdragon X Plus platform at IFA 2024 in Berlin, further strengthening its leadership in the thin and light PC market. The 8-core Snapdragon X Plus platform delivers up to 61 percent higher CPU performance and 179 percent lower power consumption than competitors' products, while maintaining high performance and providing up to several days of battery life, and its powerful GPU can support up to three external displays. With a powerful 45 TOPS NPU core, users can experience smarter, more intuitive Copilot+ functionality on their devices through advanced AI performance. “With the 8-core Snapdragon X Plus, we are bringing this transformative AI experience and superior performance to more users,” said Cristiano Amon, president and CEO of Qualcomm. Currently, some PC products equipped with the 8-core Snapdragon X Plus platform are already available. The 8-core Snapdragon X Plus platform is designed for Copilot+ PCs in the US$700-US$900 price range, which is equivalent to NT$22,500 to NT$29,000, comparable to the prices of affordable consumer laptops. It is interpreted by the industry as a sign that Qualcomm is going to enter the battle of affordable AI PCs, which will ignite a new competition in the market.

宏碁公布搭載8核Snapdragon X Plus的Swift Go 14 AI

2024-09-05 / Cool3c / Chevelle.fu

<https://www.cool3c.com/article/223836>

多家媒體報導，宏碁宣布推出Swift Go 14 AI，將以更平易近人的價格提供具備出色連網能力與長電池續航力的Copilot+ PC體驗。Swift Go 14 AI搭載8核Snapdragon X Plus，可提供17TFOPS的GPU效能，CPU單核心最高時脈3.4GHz、全核心3.2GHz，NPU算力維持45 TOPS。Swift Go 14 AI最大的特色是影片播放續航力長達28小時，觸控板同樣搭載可識別Copilot或NPU是否運作的AI指示燈號。

Acer unveils Swift Go 14 AI powered by 8-Core Snapdragon X Plus

Multiple media outlets reported that Acer has announced the launch of the Swift Go 14 AI, which will offer an affordable Copilot+ PC experience with excellent connectivity and long battery life. The Swift Go 14 AI is powered by the 8-core Snapdragon X Plus, delivering 17 TFLOPS of GPU performance, with a CPU clock speed of up to 3.4 GHz for single-core and 3.2 GHz for all cores, and an NPU performance of 45 TOPS. The standout features of the Swift Go 14 AI include its 28-hour battery life for video playback, and the touchpad includes AI indicators that show whether Copilot or the NPU is in operation.

搭載Intel Core Ultra處理器 華碩推新一代Copilot+ PC

多家媒體報導，華碩與宏碁在柏林消費電子展中發表多款搭載Intel Core Ultra處理器的AI筆電。華碩新品包括Zenbook S、Vivobook S和ExpertBook P系列及迷你電腦ASUS NUC 14 Pro。這些產品運用NPU的強大算力，最高可達48 TOPS，為用戶提供卓越的AI運算效能。全新Zenbook S 14(UX5406)14吋將於9/6中午開放預購；16吋Zenbook S 16 (UX5606)預計Q4在台上市， Vivobook S 14預計年底在台上市；ExpertBook P系列商用筆電預計於2025年推出。而宏碁宣布推出搭載不同級別Intel Core Ultra 200V系列處理器的Swift 14 AI與Swift 16 AI筆電，支援Acer的AI增強功能，適用於視訊會議與文件處理。此外推出商務筆電TravelMate P6 14 AI，強調輕便與耐用，提供卓越的AI運算效能與Intel EVO認證。Acer Swift 14 AI(SF14-51/T)三款機型建議售價為新台幣44,900元至49,900元，於9月6日率先開放預購。

ASUS Launches New Copilot+ PCs Powered by Intel Core Ultra Processors

Multiple media outlets reported that ASUS and Acer have unveiled several AI laptops featuring Intel Core Ultra processors at the IFA Berlin trade show. ASUS's new releases include the Zenbook S, Vivobook S, ExpertBook P series, and the ASUS NUC 14 Pro mini PC. These products harness the powerful computing capabilities of their NPU, reaching up to 48 TOPS, delivering exceptional AI performance for users. The new 14-inch Zenbook S 14 (UX5406) will be available for pre-order at noon on September 6; the 16-inch Zenbook S 16 (UX5606) is expected to launch in Taiwan in Q4, with the Vivobook S 14 expected to hit the Taiwanese market by the end of the year. The ExpertBook P series business laptops are scheduled for release in 2025.

Acer also announced the launch of the Swift 14 AI and Swift 16 AI laptops, featuring different levels of Intel Core Ultra 200V series processors, which support Acer's AI-enhancement functions designed for video conferencing and document processing. Additionally, Acer introduced the TravelMate P6 14 AI, a business laptop emphasizing portability and durability, with exceptional AI performance and Intel EVO certification. The Acer Swift 14 AI (SF14-51/T) series includes three models, priced between NT$44,900 and NT$49,900, with pre-orders starting on September 6.

[**Qualcomm相關新聞**](#Qualcomm相關新聞)

三星改手機策略，S 系列採高通技術、摺疊機配備 Exynos 晶片

三星S25系列傳配高通S8 Gen 4 摺疊新機可能全用Exynos 2500

平價版Copilot+ PC要來了！高通推出8核心Snapdragon X Plus

高通強攻 AI PC 打平價牌 將降價至2.25萬元

宏碁擴大Copilot+ PC陣容！Intel、AMD、高通新機大拼戰宏碁進軍掌上型遊戲市場！直擊首款Nitro Blaze 7動手玩

高通推出Snapdragon X Plus 8核心：為入門用戶帶來Copilot+

高通推出最新AI PC 晶片 擴大挑戰超微和英特爾

高通公布8核心版Snapdragon X Plus，鎖定799美金等級、劍指Ryzen 8000、第一代Core Ultra裝置

高通執行長親征IFA展 　新8核心平價AI PC 平台700美元來搶市

《科技》高通拚擴展AI PC下猛藥 Snapdragon X Plus亮相

[**MediaTek相關新聞**](#聯發科相關新聞)

宏碁公布Acer Iconia X12平板電腦，搭載聯發科Helio G99處理器、12.6吋2.5K OLED螢幕

[**無線通訊市場**](#無線通訊市場相關新聞)

[**智慧型手機/消費性電子產品**](#智慧型手機)

華碩推出Zenbook S14、Vivobook S14等搭載Core Ultra 200V系列的消費級Copilot+ PC

Qualcomm接續推出8組性能核心構成的Snapdragon X Plus處理器，擴大「Copilot+ PC」產品陣容同樣標榜搭載可提供45TOPS算力的NPU設計

Copilot+ PC 陣容添新成員，AMD Ryzen AI 300、Intel Core Ultra 200V 入列

微軟證實從今年11月開始，搭載Intel、AMD新款筆電處理器的筆電也能被稱作「Copilot+ PC」原本僅由Qualcomm獨佔使用名稱

平價革命，PC 正在流行？

英特爾力拚 AI PC 市場，Core Ultra 200V 系列產品本月上架

[**其他業界重要訊息**](#其他業界重要訊息)

Intel 展示 Lunar Lake 生產力與遊戲功耗的出色表現

小米 Xiaomi 15 Ultra 手機相機曝料：主鏡頭升級、2 億像素長焦、10 倍變焦、4K 電影模式， Xiaomi 15 系列已通過認證

英特爾絕地反攻 最新AI處理器承諾3個「最」

6.3吋螢幕？vivo X200正面設計模擬圖透露可能的外觀設計

華碩公布搭載Core Ultra 200V平台的ASUS ExpertBook P5商用筆電與ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦

宏碁推出搭載Intel Core Ultra 200V系列的Swift 14 AI與Swift 16 AI，還有商務機型TravelMate P6 14 AI

宏碁端海量新品 電競筆電概念機亮相

Lunar Lake全由台積電製造　英特爾還需留晶圓代工？

宏碁公布採8核心版Snapdragon X Plus的Swift Go 14 AI

台積電：AI 主導未來半導體市場，A16 製程＋12 個 HBM4 設計 2027 年推出

未來藍圖要角！台積電重心逐步往 CoWoS-L 邁進

3Q24 全球智慧手機產量微幅回升，但仍呈約 5% 年衰退

|  |
| --- |
| **Qualcomm相關新聞** |

高通推全新8核Snapdragon X Plus平台 專為Copilot＋ PC使用者設計

2024-09-04 / 工商時報 / 張珈睿

<https://www.ctee.com.tw/news/20240904701875-430502>

於2024年柏林消費性電子展（IFA 2024），高通隆重推出全新的8核Snapdragon X Plus平台，擴展其Snapdragon X系列產品組合，進一步鞏固其在輕薄型PC市場中的領先地位。該款全新平台專為700至900美元價位區間的Copilot＋ PC而設計，旨在為廣大消費者和企業使用者帶來卓越的效能、長時間的電池續航力，以及突破性的AI驅動體驗。

Snapdragon X Plus平台以8核心的高通Oryon CPU為基礎，具備如閃電般迅速的反應速度和效率，與同類產品相比，其CPU效能提升高達61％，而功耗則比競爭對手低179％。這使得搭載該平台的PC能夠在維持高效能的同時，提供長達數日的電池續航力，滿足現代使用者對行動裝置長時間使用的需求。此外，Snapdragon X Plus還配備強大的GPU，可支援多達三台外部顯示器，提供優異的圖像處理能力和沉浸式視覺體驗，為用戶帶來全方位的高品質電腦使用體驗。

Snapdragon X Plus的另一大亮點在於其配備了45 TOPS的強大NPU核心，這一突破性技術將AI處理能力提升到新的高度。憑藉先進的AI性能，使用者可以在裝置上體驗到更為智能、直觀的Copilot＋功能，無論是處理日常工作還是進行高效的內容創作，這一平台都能為使用者提供更為流暢和高效的使用體驗。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon提到：「Snapdragon X系列平台為全球首款也是目前全球最佳的Copilot＋ PC提供了支援，開創了個人運算的新時代。現在，我們透過8核Snapdragon X Plus，將這一變革性的AI體驗和卓越效能帶給更多使用者，這都要歸功於我們高效能的客製化Oryon CPU和領先業界的NPU技術。我們非常自豪能與全球領先的OEM廠商和零售夥伴合作，擴展我們的產品組合，為企業客戶和消費者帶來更多的價值。」

微軟Windows＋裝置部門副總裁Pavan Davuluri則指出：「高通的8核Snapdragon X Plus平台為Copilot＋ PC帶來了令人驚艷的能量和動能，尤其是其強大的NPU技術，將為更多使用者帶來全天候的電池續航力和無與倫比的效能。我們期待未來能與高通進一步合作，推動Windows生態系統的AI技術發展，拓展Copilot＋ PC的潛力。」

目前，搭載8核Snapdragon X Plus平台的部分PC產品已經上市，未來將有更多裝置陸續推出，為全球用戶帶來全新的數位體驗。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

高通推出最新AI PC晶片 劍指超微與英特爾

2024-09-04 / 工商時報 / 鄭勝得

<https://www.ctee.com.tw/news/20240904701907-430502>

高通（Qualcomm）4日推出一款新的個人電腦處理器，希望搭上電子設備製造商競相將人工智慧（AI）技術整合至裝置的潮流，進一步挑戰英特爾與超微在電腦處理器市場的主導地位。

高通週三在德國柏林消費性電子展（IFA）上首次展示Snapdragon X Plus 8核心。該處理器專為搭載微軟Windows作業系統的電腦設計，能夠支援AI運算並延長電池續航力。高通表示，Snapdragon X Plus 8核心專為價格低至700美元的個人電腦設計，希望將自家半導體擴展到更多設備。

高通去年推出用於個人電腦的Snapdragon X系列，如今該系列進一步擴增產品組合。該系列基於英國晶片設計大廠Arm的架構設計，能以絕佳能源效率運行複雜的應用程式，這對於延長設備電池壽命至關重要。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

高通新AI PC晶片 強碰超微、英特爾

2024-09-05 / 工商時報 / 鄭勝得

<https://www.ctee.com.tw/news/20240905700134-439901>

高通（Qualcomm）4日推出一款新的個人電腦處理器，希望搭上電子設備製造商競相將人工智慧（AI）技術整合至裝置的潮流，進一步挑戰英特爾與超微在電腦處理器市場的主導地位。

高通周三在德國柏林消費性電子展（IFA）上首次展示Snapdragon X Plus 8核心。該處理器專為搭載微軟Windows作業系統的電腦設計，能夠支援AI運算並延長電池續航力。

高通表示，Snapdragon X Plus 8核心專為價格低至700美元的個人電腦設計，希望將自家半導體擴展到更多設備。

高通去年推出用於個人電腦的Snapdragon X系列，如今該系列進一步擴增產品組合。該系列基於英國晶片設計大廠Arm的架構設計，能以絕佳能源效率運行複雜的應用程式，這對於延長設備電池壽命至關重要。

高通過去是手機晶片大廠，為全球各大品牌智慧型手機設計晶片，包括三星在內。但高通2024年加大進軍電腦市場的力道。

微軟日前便宣布推出配備高通X系列晶片的Surface Laptop與Surface Pro平板電腦，這些晶片能在沒有網路連線的情況下運行部分AI任務。微軟將這些裝置稱為「Copilot+ PC」。

研調機構Counterpoint Research合夥人沙哈（Neil Shah）表示：「自從去年AI熱潮開始，一切事物都圍繞AI展開，這對高通非常有利，因為他們在低功耗AI手機設備體驗方面處於領先地位，而將此一技術應用至電腦並不是太困難。」

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

高通拚擴展AI PC下猛藥 Snapdragon X Plus亮相

2024-09-05 / 時報資訊 / 郭鴻慧

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240905001391-260410?ctrack=pc_main_rtime_p06&chdtv>

高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示，全球首款也同時是全球最佳的Copilot+ PC 由Snapdragon系列平台提供支援，開創個人運算的新世代，這一切都歸功於高通突破性的NPU。現在透過8核Snapdragon X Plus，高通為全球更多使用者帶來變革的AI體驗，以及由我們高功效的客製化高通Oryon CPU所提供的同級最佳效能和前所未有的電池續航力。高通將與領先的全球OEM廠商和零售夥伴攜手，擴展我們的產品組合，驅動企業客戶和消費者。

高通8核Snapdragon X Plus維持其在輕薄型PC中的效能領先地位，配備客製化的高通Oryon CPU和同級中最佳的功耗效率，為使用者提供反應迅速的效能和多達數日的電池續航。

另外，目前有宏碁(2353)、華碩(2357)、戴爾、惠普、聯想、三星等大廠將推出搭載8核Snapdragon X Plus的產品，部分裝置現已上市。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

高通推出最新AI PC 晶片 擴大挑戰超微和英特爾

2024-09-05 / 自由時報 / 吳孟峰

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4790282>

高通週三（4日）推出一款新的個人電腦處理器，有助電子製造商將人工智慧應用到其設備上的願望，這也加大高通挑戰英特爾和超微地位的力度，而英特爾正在PC處理器市場面臨越來越大的挑戰。

高通在德國柏林舉行的IFA大會上揭開Snapdragon X Plus 8 核心的神秘面紗，此處理器專為執行Microsoft 的PC 設計Windows作業系統，預計將為人工智慧進程提供較長的電池壽命。

最新的晶片擴展高通去年推出的用於個人電腦的Snapdragon X 系列。Snapdragon X Plus 8 核心專為價格低至700 美元的PC設計，因為高通希望將半導體擴展到更多設備。

同時，高通的Snapdragon X系列是基於英國晶片設計公司安謀（Arm）的架構構建，允許處理器以良好的能效運行複雜的應用程式，這是延長設備電池壽命的關鍵。

高通傳統上設計的晶片被用於包括三星在內的許多全球最大廠商的智慧型手機中，但該公司今年加大在PC領域的努力。

微軟宣布推出配備高通X系列晶片的Surface Laptop和Surface Pro平板電腦，這些晶片可以在沒有網路連線的情況下運行一些人工智慧任務，微軟稱這些為Copilot+ PC。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

高通強攻 AI PC 打平價牌 將降價至2.25萬元

2024-09-05 / 經濟日報 / 鐘惠玲、吳凱中

<https://money.udn.com/money/story/11162/8207248>

高通強攻AI PC市場出大招，昨（4）日宣布推出全新安謀（Arm）架構八核心驍龍X Plus處理器，終端產品售價降至700美元到900美元（約新台幣2.25萬至2.9萬元），與當下一般消費型平價筆電相當。業界解讀，這意味高通大打平價AI PC戰，將引動新一波市場競爭。

原本品牌廠預期，AI PC因單價較一般筆電高，可望拉升產品平均單價（ASP），隨著高通開出平價AI PC第一槍，後續對品牌廠銷售影響值得關注。

高通昨天舉行IFA展前記者會，總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）釋出新產品訊息。

高通先前已推出驍龍X系列處理器，主打專為AI應用設計的NPU達45 TOPS（每秒兆次操作），強調高效能、更省電，相關入門款搭載驍龍X系列處理器的AI PC要價約1,000美元起跳，高階版甚至要價1,600美元至1,700美元以上。

如今高通新處理器終端產品售價壓至700美元至900美元，並打出符合微軟Copilot+ PC規格要求，等於比先前的產品最高打了近五折，話題性十足。外界解讀，這意味高通AI PC戰線從中高階機種，進一步擴大到平價市場，加大市場競爭力道。

高通先前的安謀架構AI PC處理器包含12核心的驍龍X Elite，以及十核心的驍龍X Plus產品。據了解，這次八核心驍龍X Plus產品也是採用台積電（2330）4奈米製程生產。

高通強調，藉由這項產品，消費者與企業使用者將透過45 TOPS NPU，帶來突破性裝置上的AI體驗，並在更多裝置上導入Copilot+。包括宏碁（2353）、華碩（2357）、戴爾、惠普、聯想、三星等大廠均將推出搭載八核心驍龍 X Plus處理器的終端裝置，且部分裝置現已上市。

在記者會上，包括華碩全球副總裁暨消費產品事業處張仰光，以及宏碁、惠普、聯想與三星五大廠與微軟高階主管均現身力挺高通。

高通標榜八核心驍龍X Plus可提供更快的CPU效能，而競爭對手的產品在同效能所需功耗多出179％。

艾蒙表示，全球首款、同時也是全球最佳的Copilot+ PC，是由驍龍X系列平台提供支援，這一切都歸功於其突破性的NPU。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

平價版Copilot+ PC要來了！高通推出8核心Snapdragon X Plus

2024-09-05 / 手機王 / 張里歐 Leo

<https://www.sogi.com.tw/articles/qualcomm/6262840>

高通在 IFA 2024 展前，宣布推出搭載 8 核心的 Snapdragon X Plus，進一步擴展其 Snapdragon X 系列產品組合，而該平台也將為使用者提供多達數日的電池續航力、前所未有的效能和 AI 驅動的 Copilot+ 體驗，幫助 OEM 廠商推出 700~900 美元價格範圍內的 Copilot+ PC。包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、三星等都將推出搭載 8 核心的 Snapdragon X Plus 裝置。

高通於 4 月底就發表了 Snapdragon X Plus，當時版本搭載 10 核心的 Oryon CPU，而最新推出的版本同樣是 4 奈米製程，但採用 8 核心的 Oryon CPU，主打提供高達 61% 的 CPU 效能提升，同時在同等效能下，其功耗比競爭對手低 179%。平台整合了強大的 Adreno GPU，並支援多達三台外部顯示器，確保卓越的圖像處理能力和沉浸式視覺體驗。

不管是 8 核心或是 10 核心版本的 Snapdragon X Plus，皆擁有 AI 算力高達 45TOPS 的 Hexagon NPU，能提供領先的 AI 處理能力和每瓦效能，再加上搭載 Snapdragon X65 5G 數據機及射頻系統，使其具備驚人的電池續航力，同時帶來極致的便攜設計。

高通總裁暨執行長 Cristiano Amon 表示，全球首款 Copilot+ PC 是由 Snapdragon X 系列平台支援，這要歸功於高通突破性的 NPU。現在，透過 8 核心的 Snapdragon X Plus，高通能為全球更多使用者帶來革新的 AI 體驗，並結合高效能的客製化 Oryon CPU，提供同級最佳效能和前所未有的電池續航力。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

高通推出Snapdragon X Plus 8核心：為入門用戶帶來Copilot+

2024-09-04 / XFastest / sxs112.tw

<https://www.xfastest.com/thread-291883-1-1.html>

高通推出了全新的Snapdragon X Plus 8核心CPU，為主流用戶帶來了Copilot+ PC 45 TOPS的AI效能。

到目前為止Snapdragon X系列由12核心Elite和10核心Plus版本組成，但今天高通為其產品線添加了全新的8核心Plus系列，其目標是希望利用Microsoft Copilot+功能和功能強大的辦公室/家庭設定的主流受眾。

今天發布的一些亮點：

高通CEO Cristiano Amon在IFA之前登台亮相，公佈了Snapdragon X系列產品組合的擴展，使OEM能夠提供700至900美元內的 Copilot+ PC。

Snapdragon X Plus 8核心在輕薄PC中保持性能領先地位，搭配定制的Qualcomm Oryon CPU和一流的能效，為用戶提供響應性能和多天的電池續航時間。

消費者和企業用戶將透過45 TOPS NPU獲得突破性的設備端AI體驗，將Copilot+導入更多設備。宏碁、華碩、戴爾科技、惠普、聯想和三星將提供Snapdragon X Plus 8核，部分設備現已上市。

市場上的Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus筆記型電腦價格大多超過1000美元，但高通正在改變這種狀況，推出8核型號，起價799美元，提供與頂級晶片相同的45個AI TOPS，同時保留不錯的性能和電池續航。

規格方面，Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100和X1P-46-100配備八個採用4nm製程的Oryon CPU核心，核心分為兩個集群，其中一個集群。單核心和多核心升壓時脈額定為3.4和3.2GHz，高階型號的最大單核心和多核心升壓時脈為3.4和4.0GHz。 CPU包含30MB的總快取，每個叢集提供12MB的L2 。

GPU方面，Qualcomm Snapdragon X Plus 8核心CPU採用Adreno X1-45 GPU作為整合晶片，運算能力分別為2.1和1.7 TFLOP。高階10核心和12核版本有3.8TFLOP和高達4.6 TFLOP的運算能力。兩款型號均保留LPDDR5x DRAM支援，速度為8448MT/s，NPU提供45 TOPS的AI運算能力。

在效能方面，高通將Snapdragon X Plus 8核心CPU與Ryzen 7 8840U、Ryzen 5 8640U、Core Ultra 7 155U和Core Ultra 5 125U等入門級晶片進行了比較。在 Geekbench和3DMark Wildlife等CPU和GPU工作負載方面對CPU進行了比較，高通公司展示了一些顯著的性能提升，但是現實世界的測試確實描繪了一個不同的故事。

然而正確的一件事是，如果高通能夠推出大量價格確實為799美元的Copilot+ AI PC產品，那麼這將使Snapdragon X Plus 8核成為45 TOPS中最實惠的選擇因為截至目前所有競爭PC的價格都在1000美元以上。入門級Hawk Point和Meteor Lake選項不提供與Snapdragon X的45 AI TOPS相同等級的TOPS。

該公司還分享了電池時間，聲稱在Teams視訊通話等一系列工作負載中，電池壽命比競爭對手長2倍。對於日常辦公室或家庭使用來說擁有更長的電池使用時間至關重要，因為沒有人希望自己的裝置在OTG時始終連接到電源。

最後高通對其Snapdragon X Plus 8核心與Apple M2 (MacBook Air) 平台進行了官方比較，展示了Geekbench (MT) 和Procyon中更高的性能，同時強調了相對於蘋果解決方案（例如WiFi 7）的一些主要平台優勢、5G（可選）、藍牙5.4、更高的記憶體頻寬、更多的USB4連接埠、更多的外部顯示器支援和AV1視訊（編碼/解碼）。

首批Qualcomm Snapdragon X Plus 8核心筆記型電腦將於今日由宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想和三星等領先OEM廠商發售，起價為上述799美元（美國）。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

高通公布8核心版Snapdragon X Plus，鎖定799美金等級、劍指Ryzen 8000、第一代Core Ultra裝置

2024-09-04 / Cool3c / Chevelle.fu

<https://www.cool3c.com/article/223564>

高通在2024年積極擴大Snapdragon PC的布局，繼公布終端裝置999美金起的12核心Snapdragon X Elite、10核心Snapdragon X Plus後，於IFA宣布8核心版Snapdragon X Plus，雖然核心減少、GPU性能下調，但NPU維持45TOPS的AI算力，將搭載Snapdragon X平台的Copilot+ PC價格進一步壓低至799美金起，以The everyday PC, reborn(日常個人電腦再定義)，目標將鎖定AMD Ryzen 8000、Intel Core Ultra(Series 1)與蘋果M2。

包括宏碁、華碩、Dell、HP、聯想、三星等皆宣布將推出搭載8核版Snapdragon X Plus的Windows 11 Copilot+ PC，也能夠適用於各種形式的PC產品。

8核心版Snapdrgaon X Plus也與其它兩款平台同為高通Oryon CPU搭配Adreno GPU，並以4nm製程製造；識別標誌與10核心版本同為銀色系，但識別圖形僅以銀邊描繪；8核心版Snapdragon X Plus與10核心版本同樣不支援Core Boost，提供兩種版本，包括單核心時脈最高4GHz，多執行緒的最高時脈為3.4GHz、具2.1TFLOPS性能GPU的高階版，以及最高時脈3.4GHz、多執行緒3.2GHz與1.7TFLOPS GPU的版本；兩版本保有45TFLOPS的NPU性能，能夠執行完整的微軟Copilot+ PC功能，並強調也具備出色的續航力與低發熱。

8核心版Snapdrgaon X Plus雖然GPU性能相對縮減，但同樣可支援最高UHD HDR10 120Hz面板，以及支援3路4K 60Hz訊號輸出或2路5K 60Hz訊號輸出，當然也同樣支援AV1編碼功能。另外也具備高通Snapdragon的智慧體驗，諸如可選配5G的高速網路連接、沉浸式音效、高性能視訊增強處理、高度的安全性以及可與Android手機連接互動的能力。

高通也列出多項性能比較，劍指競爭對手相近價位的平台，強調不僅性能更為出色，也提供更優異的續航力，使更多使用者能享受性能與續航力兼具的Copilot+ PC增強體驗。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

高通執行長親征IFA展 新8核心平價AI PC 平台700美元來搶市

2024-09-05 / 太報 / 陳俐妏

<https://www.taisounds.com/news/content/76/145664>

柏林消費性電子展（IFA 2024）登場，高通執行長Cristiano Amon為宣傳AI PC首度親征，展前宣布推出8核Snapdragon X Plus，將同樣具有45 TOPS NPU的AI PC壓低至700美元平價價格帶，叫陣AMD、英特爾和蘋果。品牌廠宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、三星等也將搭載推出，部分裝置現已上市。

高通今年以AI PC為主力，積極拓寬Snapdragon PC的布局，除了999美元起的12核心Snapdragon X Elite、10核心Snapdragon X Plus，傳聞已久的8核心Snapdragon X Plus，終於在IFA亮相。

Snapdragon X Plus 核心數雖減少、GPU性能下調，不過NPU維持45TOPS的AI算力，價格進一步壓低至700~900美元，看得出叫陣AMD Ryzen 8000、Intel Core Ultra與蘋果M2的企圖心。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示，全球首款也同時是全球最佳的Copilot+ PC由高通Snapdragon X系列平台提供支援，開創個人運算的新世代，這一切都歸功於高通的NPU。現在透過8核Snapdragon X Plus，高功效的客製化高通Oryon CPU所提供的同級最佳效能，高通為全球更多使用者帶來變革的AI體驗。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

Qualcomm接續推出8組性能核心構成的Snapdragon X Plus處理器，擴大「Copilot+ PC」產品陣容同樣標榜搭載可提供45TOPS算力的NPU設計

2024-09-04 / Mashdigi / 楊又肇

<https://mashdigi.com/qualcomm-continues-to-launch-the-snapdragon-x-plus-processor-composed-of-8-sets-of-performance-cores-expanding-the-copilot-pc-product-lineup/>

接續先前推出的Snapdragon X Elite與Snapdragon X Plus處理器產品，Qualcomm在IFA 2024展前活動揭曉採8組性能核心構成的Snapdragon X Plus處理器，同樣標榜搭載可提供45TOPS算力的NPU設計，藉此驅動符合微軟「Copilot+ PC」設計的筆電機種。

以目前推出的Snapdragon X系列處理器，採12核心配置的Snapdragon X Elite依然定位在旗艦產品，而主流市場應用需求則以10核心設計的Snapdragon X Plus處理器對應，此次推出採8組性能核心 (其中一組為大核設計)構成的Snapdragon X Plus則目標用於更普及化使用需求筆電設計，強調一定可提供足夠效能，以及透過對應45TOPS運算效能的NPU滿足更多人工智慧服務運算需求。

跟先前推出的Snapdragon X系列處理器一樣，此次推出採8組性能核心構成的Snapdragon X Plus也能對應更長電池續航時間，並且以8組「Oryon」架構CPU構成，可對應更快執行反應速度，同時能讓OEM業者以輕薄形式打造筆電。

而此次推出的Snapdragon X Plus，分別推出型號為「X1P-46-100」、「X1P-42-100」兩種版本，CPU運作時脈在單執行緒情況下可達3.4GHz或4.0GHz，多執行緒情況下則為3.2GHz或3.4GHz，而NPU執行效能一樣維持在45TOPS，藉此對應裝置端人工智慧運算需求。

內建Adreno GPU則可對應2.1TFLOPS運算效能，最高可外接三組4K 60Hz規格獨立顯示輸出，或兩組5K 60Hz規格獨立顯示輸出，並且配置30MB快取記憶體、支援LPDDR5x記憶體，最高可對應64MB、8通道配置，CPU運作時脈在單執行緒情況下可達3.4GHz，多執行緒情況下則為3.2GHz，而NPU執行效能一樣維持在45TOPS，藉此對應裝置端人工智慧運算需求。

連接功能部分則搭載Snapdragon X65 5連網數據晶片，對應最高10Gbps下載速度與3.5Gbps上傳速度，另外也配置FastConnect 7800無線連接系統，對應Wi-Fi 7、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 6等無線連接規格。

至於首波推出搭載採8組性能核心構成Snapdragon X Plus設計筆電產品的業者，分別包含華碩、宏碁、HP、聯想、Dell、三星，其中部分產品已經在市場開放銷售，同時也有更多機種將在後續於市場推出。

與同級的Intel Core Ultra 7 155U、AMD Ryzen 7 8840U，以及蘋果M2處理器效能比較

Qualcomm此次也同步釋出此次推出8組核心設計Snapdragon X Plus與Intel Core Ultra 7 155U及AMD Ryzen 7 8840U的性能比較，另外也公布與蘋果M2處理器性能比較結果。

與蘋果M2處理器性能比較：

與Intel Core Ultra 7 155U及AMD Ryzen 7 8840U的性能比較：

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

高通催下去！爆料人稱 S8 Gen 4 時脈將高達 4.37GHz

2024-09-04 / ePrice / dddd204

<https://www.eprice.com.tw/mobile/talk/102/5812115/1>

將於下個月正式發表的新一代高通 Snapdragon 8 Gen 4 處理器，先前已經在跑分資料庫流出了不錯的效能成績，而且還有可能更高？根據爆料人的新消息，高通 S8 Gen 4 大核心的最高時脈，有可能將會高達 4.37GHz。

工程樣機時脈超乎先前預期

爆料人數碼閒聊站在微博上透露，目前高通 S8 Gen 4 工程樣機的大核心最高時脈，已經來到了 4.37GHz。先前同樣來自數碼閒聊站的消息，高通 S8 Gen 4 大核心時脈將會高達 4GHz，並且有機會進一步提高到 4.26GHz，看來 S8 Gen 4 的開發比之前預計的還要順利。

先前高通 Snapdragon 8 Gen 4 的 Geekbench 跑分搶先曝光，在最高 4GHz 時脈的狀況下，單核心成績上與 A17 Pro Bionic 處理器打平，如果 S8 Gen 4 的最終時脈近一步提高，CPU 效能上有機會全面超越 A17 Pro Bionic，接著就要看蘋果今年的 A18 系列處理器進步幅度，能不能再與高通拉開距離了。

除了蘋果，高通近年的勁敵聯發科天璣 9400 目前最高時脈 3.66GHz，已經比前一陣子的 3.4GHz 提高了一點，表面數據尚不比 S8 Gen 4，但數碼閒聊站表示聯發科也可能繼續將時脈調高，來與高通 S8 Gen 4 一較高下。

數碼閒聊站也指出目前高通與聯發科在極限效能下的功耗表現仍然不佳，不過在特定使用狀況下，功耗仍然比前代好，並且在 GPU 的能耗比進步明顯。高通 S8 Gen 4 與聯發科天璣 9400 將在 10 月相繼發表，相關產品也傳言將隨後推出，高通重新推出的 Oryon 自有架構，對上聯發科的 ARM 全大核架構表現如何，我們很快就能看到結果了。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

高通推出新款AI PC晶片 叫陣英特爾與超微

2024-09-05 / 鉅亨網 / 段智恆

<https://news.cnyes.com/news/id/5708052>

高通 (QCOM-US) 周三 (4 日) 在 2024 年柏林消費性電子展 (IFA 2024) 推出全新的 8 核 Snapdragon X Plus 平台，擴展其 Snapdragon X 系列產品組合，不僅進一步鞏固其在輕薄型個人電腦 (PC) 市場中的領先地位，還帶來突破性的人工智慧 (AI) 驅動體驗，加大挑戰英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 地位的力道。

據了解，Snapdragon X Plus 平台專為 700 至 900 美元價位區間的 Copilot+ PC 設計，旨在為廣大消費者和企業使用者帶來卓越的效能、長時間的電池續航力，以及突破性的 AI 驅動體驗。

該平台以 8 核心的高通 Oryon CPU 為基礎，具備迅速的反應速度和效率，與同類產品相比，其 CPU 效能提升高達 61%，而功耗則比競爭對手低 179$。這使得搭載該平台的 PC 能夠在維持高效能的同時，提供長達數日的電池續航力，滿足現代使用者對行動裝置長時間使用的需求。

不只如此，Snapdragon X Plus 還配備強大的 GPU，可支援多達三台外部顯示器，提供優異的圖像處理能力和沉浸式視覺體驗，為用戶帶來全方位的高品質電腦使用體驗。

值得注意的是，高通的 Snapdragon X 系列是基於英國晶片設計公司安謀 (ARM-US) 的架構構建，讓處理器以良好的能效運行複雜的應用程式，這是延長設備電池壽命的關鍵。

高通執行長艾蒙 (Cristiano Amon) 受訪時表示，進軍 PC 晶片是擺脫行動晶片組更廣泛「多元化」計畫的一部分，與此同時也一直在發展不斷成長的汽車業務，AI 是策略的關鍵部分。

艾蒙說：「我們正走在多元化的道路上，確保我們的技術正在向其他市場擴張。」他還指出，PC 市場正在發生「根本性」的變化，原因有兩個：行動設備與 PC 的融合——換句話說，大眾開始期望在電池壽命等方面獲得與手機相同的性能——以及 AI 與桌上型電腦的融合。

展望未來，艾蒙表示高通未來的目標是將該公司專注於 AI 的 Snapdragon X 系列晶片擴展到所有個人運算設備，包括小型 PC。他說：「現在的重點是讓 AI PC 成為主流。我們看到從規模上擴大桌上型電腦市場的大好機會。接下來，我們也將看到高通的迷你桌上型電腦，我們將繼續增加產品和路線圖，最終擁有全系列產品。」

分析師表示，高通進入 PC 領域的時機是關鍵。Counterpoint Research 的合夥人 Neil Shah 強調 AI 應用程式在硬體上而不是透過網路進行處理的推動，而高通已替智慧型手機設計這樣的處理器。

Shah 受訪時說：「自去年 AI 熱潮爆發以來，一切都圍繞著 AI 展開，這對高通來說很好，因為他們在行動端低功耗 AI 設備體驗方面一直處於領先地位，而將其轉化為 PC 形式並不難。 」

另一方面，微軟 (MSFT-US) 的支持對高通打入 PC 主流市場也很重要，因為 Windows 是全球最大的作業系統之一。Shah 認為高通的形勢已經明朗。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

高通發表Snapdragon X處理器，具備更強AI性能及優於對手的能耗比

2024-09-05 / LPComment / 劉胖胖

<https://lpcomment.com/2024/09/05/%e9%ab%98%e9%80%9a%e7%99%bc%e8%a1%a8snapdragon-x%e8%99%95%e7%90%86%e5%99%a8%ef%bc%8c%e5%85%b7%e5%82%99%e6%9b%b4%e5%bc%b7ai%e6%80%a7%e8%83%bd%e5%8f%8a%e5%84%aa%e6%96%bc%e5%b0%8d%e6%89%8b%e7%9a%84/>

高通稍早在 2024 年柏林消費性電子展（IFA 2024）所舉辦的展前記者會中宣布推出 8 核心的 Snapdragon X Plus 處理器。其內建 8 核心的高通 Oryon CPU，CPU 效能提升 61%。競爭對手（Intel Core Ultra 7 155U）在效能下的功耗表現則是 Snapdragon X 的 179%。其搭載整合 GPU 和並支援多達三台外部顯示器，並有更好的圖像表現和沉浸視覺體驗。8 核 Snapdragon X Plus 具備 45 TOPS 的 NPU 核心，具備優異的 AI 處理能力和領先的每瓦效能，結合平台在連網方面亦有所進步，可支援 5G 網路噢 Wi-Fi 7，同時支援更優異的電池續航力與超便攜的設計。

高通發表Snapdragon X處理器，具備更強AI性能及優於對手的能耗比

Snapdragon X預計將提供OEM廠商推出 700 至 900 美元價位帶的 Copilot+ PC 使用。目前華碩、戴爾、惠普、聯想、三星等大廠均將會推出搭載8 核Snapdragon X Plus的產品，部分裝置現已上市。更多關於8 核Snapdragon X Plus的資訊（含規格），請造訪網頁和產品簡介。

高通發表Snapdragon X處理器，具備更強AI性能及優於對手的能耗比

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

高通驍龍XPlus8核心新晶片亮相，搶攻700美元級AI PC

2024-09-05 / 財訊快報 / 陳孟朔

<http://www.investor.com.tw/onlineNews/NewsContent.asp?articleNo=14202409050058>

全球手機晶片大廠--高通(美股代碼QCOM)驍龍(Snapdragon)XPlus8核心新晶片在IFA柏林電子展正式亮相，採4奈米製程，令設備可以有更佳的續航能力，專為價格低至700美元的AI PC設計，因為公司希望其晶片擴展至更多設備。

新晶片延續去年推出用於電腦的驍龍X系列，先後推出12核心Snapdragon X Elite、10核心Snapdragon X Plus，今次雖然為較低階款式，但NPU維持10核心版本的45TOPS的AI算力。

高通晶片一直應用於高階手機中，例如小米(1810.HK)高階及三星手機，高通近期搶攻AI PC領域，例如新近配備Copilot+AI功能的電腦，可以在沒有網路的情況下使用AI功能。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

高通推出8核Snapdragon X Plus　Copilot+ PC價格更親民

2024-09-05 / 新通訊

<https://www.2cm.com.tw/2cm/zh-tw/headline/4F9DC273663F45358E965895589DD1FF>

高通(Qualcomm)在2024年柏林消費性電子展(IFA 2024)展前宣布推出8核Snapdragon X Plus，擴展其Snapdragon X系列產品組合，助力OEM廠商推出700至900美元價格範圍內的Copilot+ PC。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示，Copilot+ PC由Snapdragon X系列平台提供支援，開創個人運算的新世代。現在透過8核Snapdragon X Plus，高通為全球更多使用者帶來革命性的AI體驗，以及由高通客製化Oryon CPU所提供的效能和電池續航力。

Snapdragon X Plus平台由8核心的高通Oryon CPU提供支援，提供61%更快的CPU效能，而競爭對手的產品在同效能的所需功耗多出179%。此平台採用整合GPU並支援達三台外部顯示器。8核Snapdragon X Plus受惠於45TOPS的NPU核心，具備先進的AI處理能力和優秀的每瓦效能，結合平台在連網方面的重大進步，將帶來具驚人電池續航力的超便攜設計，將生產力推向新高度。

宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、三星等業者將推出搭載8 核Snapdragon X Plus的產品，部分裝置現已上市。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

|  |
| --- |
| **MediaTek相關新聞** |

N/A

|  |
| --- |
| **無線通訊市場相關新聞** |

藍牙技術聯盟發布全新測距功能　通道探測為藍牙裝置帶來公分級精度

2024-09-04 / 新通訊

<https://www.2cm.com.tw/2cm/zh-tw/market/A7247BFB7B534CD097AA6AF42FAA9507>

藍牙技術聯盟(Bluetooth SIG)宣布推出藍牙通道探測(Bluetooth Channel Sounding)，其為近期發布供採用的藍牙核心規範6.0版中的新功能之一，是全新的安全精確測距功能，將進一步強化藍牙互連設備的便利性、安全性與安全保障。

三星連結性研發團隊執行副總裁Joonsuk Kim表示，藍牙通道探測將為各種藍牙裝置帶來真實的距離感知功能，為各行各業的距離感知應用開創全新的可能性。使用藍牙通道探測，將使該公司可提供公分等級的準確度、協助客戶更輕鬆地找到重要物品，以提升「尋找」應用程式的效能。藍牙通道探測還能夠強化數位鑰匙解決方案的安全性，為以無鑰匙方式進入的使用者增添一層保護。

藍牙通道探測為開發者帶來三大優點，讓他們可以為互連設備加入精確測距功能：

準確度(Accuracy)：藍牙通道探測利用相位測距(Phase-based Ranging, PBR)技術，在藍牙互連設備之間能夠高度準確地測量距離，並在非常長的距離內達到公分等級的準確度，滿足絕大多數應用的需求，並讓即使是最簡單的互連設備也能利用真實的距離感知功能。

安全性(Security)：隨著互連設備數增加，維護連線的完整不受干擾也日漸重要。藍牙通道探測部署強大的、多層的安全性防護，包括輔助測距法、往返時間(Round-Trip Time, RTT)架構的距離限制，以增加額外的保護層，對抗複雜的中間人(Man-in-the-middle attack, MITM)中繼攻擊。

普遍性(Ubiquity)：藍牙技術已內建於各大消費性平台裝置內，包括智慧型手機、平板電腦和筆記型電腦。開發者使用藍牙通道探測，無需設計額外的無線技術解決方案，即可為藍牙互連設備加入真實的距離感知功能。

藍牙通道探測這項全新功能，將有可能為生活中的各種應用帶來改變。除了可裝設在鑰匙、錢包、背包或行李等個人物品上的藍牙追蹤器之外，已有越來越多藍牙裝置內建「尋找」功能，讓任何藍牙互連設備都能夠成為「尋找」裝置。開發者即將能夠在使用藍牙通道探測功能時，在「尋找」裝置中加入真實的距離感知功能，提高這些解決方案的準確度和使用者體驗，讓使用者更輕鬆快速地找到遺失的物品。

同時，不論是汽車、出入口、大門、保險箱到自行車等情境，都將能夠運用藍牙技術達成無鑰匙門禁開鎖，提供更安全的上鎖機制。開發者可以使用藍牙通道探測來強化數位鑰匙解決方案的安全性與使用者體驗，確保只有在授權裝置處於一定距離內時才會開鎖。

智慧車聯開放聯盟(ICCOA)秘書長馮雲昇表示，該聯盟期待在即將推出的藍牙數位鑰匙規格中加入這項新功能，採用藍牙通道探測將有助於ICCOA繼續為全球駕駛和乘客提供更大的便利性、效能和安全性。智慧車聯產業生態聯盟(ICCE)副秘書長任鋒也表示，該聯盟正研究在ICCE汽車鑰匙標準中加入藍牙通道探測技術，作為其中一種測距法，並期待將該技術納入ICCE汽車鑰匙標準。

除了「尋找」和數位鑰匙解決方案，藍牙通道探測也有可能造福其他應用，改變我們與世界連結互動的方式。ABI Research資深研究總監Andrew Zignani表示，藍牙通道探測將可用於消費者、企業及工業環境中。試想，藍牙滑鼠、鍵盤和遊戲控制器可以根據它們與筆記型電腦的距離，自動切換啟動狀態。在工業環境中，距離感知藍牙人機介面(HMI)解決方案只允許在安全距離內使用，以提高作業人員的人身安全。同時，用於連網照明控制的這類藍牙裝置網路，可以使用這項創新技術更輕鬆自主地設定，以強化系統效能。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

中華電卡位智慧交通，5G車聯網再締實績

2024-09-05 / MoneyDJ / 羅毓嘉

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=ce03a190-9a4f-4fb0-85bb-d0494735571f&c=MB07>

中華電(2412)積極以5G技術卡位多項智慧治理應用領域，近期以5G車聯網技術，與高雄市政府攜手合作，打造輕軌路口安全智慧輔助系統，以5G網路低延遲、高速率的優勢，結合光達、雷達設備等感測設備與AI預判系統的整合，全天候監控路口汽機車動態，並將預判到的路口事件訊息推播至輕軌車載裝置，提升輕軌系統的安全，為中華電5G系統落地再添實績。

中華電說明，藉由該預警系統，當有違規車輛闖入路口時，系統透過5G C-V2X蜂巢式車間通訊技術，迅速將警報傳遞至輕軌列車，輔助駕駛提前判斷前方路口情形，有效降低事故風險。

在系統規格方面，中華電表示，這是中華電首次在軌道系統採用5G C-V2X技術，也成就5G戶外N79頻段驗證的關鍵里程碑，未來中華電也將持續運用5G技術與智慧交通的專業經驗，推動更大範圍的智慧交通安全應用。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

|  |
| --- |
| **智慧型手機/消費性電子產品** |

宏碁公布採8核心版Snapdragon X Plus的Swift Go 14 AI

2024-09-05 / Cool3c / Chevelle.fu

<https://www.cool3c.com/article/223836>

宏碁繼宣布搭載Snapdragon X Elite的Swift 14 AI後，於高通公布8核心版Snapdragon X Plus後，再宣布更平價的Swift Go 14 AI，以更平易近人的價格提供具備出色連接性與長續航力的Copilot+ PC體驗。

Acer Swift 14 Go AI搭配14吋WUXGA 120Hz螢幕，採用的是時脈較低的8核心Snapdragon X Plus，可提供17TFOPS的GPU性能，CPU單核心最高時脈3.4GHz、全核心3.2GHz，NPU算力維持45TOPS，但最大的特色是影片播放續航力長達28小時，機身也具備兩個USB 4介面，可搭配最高32GB RAM(因應Copilot+規範最低為16GB RAM)與1TB儲存。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

搭載Intel Core Ultra處理器 華碩推新一代Copilot+ PC

2024-09-05 / 時報資訊 / 任珮云

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240905001202-260410?chdtv>

Intel是華碩將尖端裝置推向市場的重要夥伴，華碩電腦全球副總裁暨消費產品事業處張仰光表示：「最新的Zenbook、Vivobook、ExpertBook筆電和NUC迷你電腦搭載強大的Intel Core Ultra處理器，提供無與倫比的效能，並帶來豐富的AI體驗，幫助使用者充分發揮AI潛力，享受更聰明、更直觀的人機互動。」

Zenbook S系列：全新Zenbook S 14(UX5406)14吋輕薄美型機身僅1.1公分，1.2公斤，外蓋採用高科技陶瓷鋁合金(Ceraluminum)製成，結合陶瓷溫潤觸感與鋁的強度，更加堅固耐用。鍵盤面的幾何格柵設計具備2715個CNC加工散熱孔，使氣流和散熱達到最佳化以發揮優異效能。NPU最高47 TOPS，配備3K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕，視覺效果令人驚艷，四揚聲器音效系統帶來劇院級音訊體驗。Zenbook S 14 (UX5406)將於9/6中午開放預購；另有16吋Zenbook S 16 (UX5606)，同樣輕薄美型，預計Q4在台上市。

Vivobook S 14：專為行動辦公和娛樂而設計的ASUS Vivobook S 14 (S5406SA) ，全金屬纖薄機身僅1.3公斤、1.39公分，極簡設計輕薄便攜。採用ASUS IceCool散熱技術，兩個97葉片的 IceBlade風扇和兩個通風口，最大TDP為35 W，即使在嚴苛的工作負載下也能保持最佳效能。最高配備Intel Core Ultra 7處理器(系列2)和NPU 47 TOPS的AI引擎，高效執行AI應用程式表現極為出色。專屬Copilot按鍵一鍵啟動AI智能助手，75 Wh電池帶來最高22小時續航電力，以確保全天生產力。ASUS Vivobook S 14預計年底在台上市。

ASUS ExpertBook P系列商用筆電：旗艦級ASUS ExpertBook P5 (P5405)配備先進的Intel Core Ultra處理器，並整合最新ASUS AI ExpertMeet工具，透過AI翻譯、AI字幕、輔助會議摘要、AI降噪和商業浮水印等功能，徹底改變線上會議模式，帶來無與倫比的AI工作體驗，ASUS ExpertBook P5 (P5405)最高提供NPU 47 TOPS和平台總算力120 TOPS，可最佳化執行當代AI應用程式。系列中亦有ASUS ExpertBook P3 (P3405/P3605)供選擇，同樣效能極佳、耐用可靠。華碩與McAfee合作，在ASUS ExpertBook P系列商用筆電預先安裝資安防護軟體McAfee+ Premium Individual Unlimited，全球自2024年9月起可免費使用一年。未來此系列將拓展至桌機和All-in-One電腦，預計於2025年推出。

ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦：搭載最新 Intel Core Ultra 9處理器，多架構CPU、GPU 和NPU配置，以實現高達 120 TOPS的總算力，其中NPU亦顯著提升 AI 運算至 48 TOPS，為前代處理器的三倍！ASUS NUC 14 Pro AI 容量不到 0.6公升，機身高度僅3.4公分，倍增的算圖能力，搭配創新的嵌入式LPDDR5x設計，為各種物聯網情境帶來絕佳的運作表現和穩定性。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

宏碁擴大Copilot+ PC陣容！Intel、AMD、高通新機大拼戰宏碁進軍掌上型遊戲市場！直擊首款Nitro Blaze 7動手玩

2024-09-05 / 自由時報 / 吳佩樺

<https://3c.ltn.com.tw/news/59420>

今年筆電市場的焦點無疑是「AI PC」，微軟所推動的「Copilot+ PC」獲得關注，除了最早取得合作的高通Snapdragon X系列處理器，AMD Ryzen AI 300系列和Intel Core Ultra 200V系列處理器，現在也成為符合Copilot+ PC資格的處理器。

宏碁在2024德國柏林next@acer全球記者會宣布旗下「Copilot+ PC」全面到位，推出採用Intel、AMD和高通處理器的多款新機。其中新款Swift 14 AI(Intel)和Swift 16 AI(Intel)為宏碁首批搭載Intel Core Ultra 200V系列處理器的Copilot+ PC，具備48 TOPS的NPU AI運算性能，並配置3K解析度的OLED螢幕。

Swift 14 AI(Intel)可連續播放影片29小時，台灣將於9月6日開放預購，售價44,900元起，購買交機後上網憑預購單登錄送即享券1,000元。

簡單來說，未來消費者在選購Copilot+ PC時，將可選擇Intel、AMD或高通處理器的不同版本，因此需要仔細辨明。根據微軟的定義，Copilot+ PC在硬體上要求NPU至少擁有40兆次 TOPS算力，以及具備16GB記憶體和256GB儲存空間，以確保能運行更複雜的AI模型，提供更強大的AI功能。

除了Intel Core Ultra 200V系列處理器，宏碁在IFA也推出了搭載高通與AMD處理器的Copilot+ PC新機型。全新Swift Go 14 AI(高通)採用高通Snapdragon X Plus處理器，Swift 14 AI(AMD)也有配置AMD Ryzen AI 300系列處理器的版本，為消費者提供更多選擇。

此外，宏碁在商務市場也有亮點產品，TravelMate P6 14 AI強調重量低於1公斤，是業界罕見的Copilot+ PC，採用的是Intel Core Ultra 200V系列處理器。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

宏碁端海量新品 電競筆電概念機亮相

2024-09-05 / 工商時報 / 翁毓嵐

<https://www.ctee.com.tw/news/20240905700167-439901>

宏碁時隔五年、重返德國柏林舉行IFA展前全球實體發表會，以「Human Intelligence（人本智慧）」為主軸，在董事長暨執行長陳俊聖領銜下，端出含括電競、商務的Copilot+ PC全陣容新品及電競顯示器等新品，但各界目光焦點，多集中在全球首款電競筆電＋掌機的2-in-1電競新品，與宏碁首台電競掌機。

以筆電＋掌機兩用型態推出的「Project DualPlay」電競筆電概念機中，宏碁將遊戲控制器與筆電觸控板整合，透過鍵盤頂端的釋放鍵解開電磁鎖後，即可取出無線控制器，並可再拆卸成2個獨立的搖桿、進行雙人遊戲。雖目前僅是概念機，是否會量產上市未定，不過宏碁已再度成功對電競筆電市場投下新震撼彈。

宏碁也發表首款電競掌機Acer Nitro Blaze 7，採用超微AMD Ryzen 8040系列處理器，整體AI算力高達39 TOPS，儲存空間最高2TB，劍指遊戲機市場大餅。

此外，宏碁也端出了領先業界、輕於1公斤的首款商用TravelMate筆電系列的Copilot+ PC，同時針對輕薄系列發表Swift 14 AI。其所屬的Swift系列家族，此次端出的Copilot+ PC搭載英特爾Intel Core Ultra處理器（系列2），透過配置整合性NPU則提供高達48 TOPS的AI運算能力。

宏碁也從AI應用著手，軟硬雙進、宣示其積極搶攻AI意圖。其全新的GenMotion.AI應用軟體，由宏碁集團旗下唯晶科技AI研究實驗室開發，能利用AI將文字提示句生成3D遊戲動畫，專為動畫師和遊戲製作而設計，未來更新版本也將擴大範圍，可供經驗豐富專業人士和休閒創作者使用。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

看準電競市場突破NB限制　宏碁新品發表透露IT關鍵3密碼

2024-09-05 / 電子時報 / 李立達

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&id=701701>

宏碁在IFA（消費電子展）前夕發表新品，最引人矚目的是推出Project DualPlay電競NB概念機，玩家能在電競NB與遊戲機間，無縫切換。宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，將持續在大環境中找出微趨勢。

宏碁在新品發表會發表多款新品，若以類別區分，可分3塊：分別是AI、電競與ESG，此也是消費電子趨勢的3個關鍵密碼。

德國柏林將在6日~10日起舉辦IFA，集結全球各大消費電子品牌，齊將下半年新品在此舞台發表，宏碁也在IFA前夕舉辦全球新品發表會。

英特爾在IFA發表AI PC最新處理器，各大PC品牌有都發表AI PC，宏碁推出one more thing：掌上型遊戲機與Project DualPlay電競NB概念機，透露在消費電子低迷時期，宏碁也看好電競市場的強勁需求。

全球最大經濟體美國ISM公布的8月製造業指數，低於預期的47.5，僅達47.2，為連續第5個月不及50榮估線，美國景氣衰退疑慮加深，同樣意味2024年下半消費電子的動能有限。

相較於消費電子低迷，電競市場依舊火熱，宏碁在消費電子展集中火力在電競市場，也可充分反映陳俊聖經常掛在嘴邊的，要從微趨勢下手，才能營造企業更多的迎風面。

宏碁推出的Project DuaPlay突破電競NB限制，觸控板可轉換成無線遊戲手把，玩家只需將雙指放在鍵盤釋放鍵上，可解鎖電磁鎖，將無線遊戲控制器取出。2個高傳真5W喇叭也將同時從NB兩側彈出。

Project DualPlay 的無線控制器可再拆卸成2個獨立的搖桿，在鍵盤、螢幕邊框和大型觸控板等區域，皆配備360度的動態RGB燈光效果，以增添視覺魅力。宏碁表示，概念機無上市時間表，敬請期待。

宏碁也同時發表首款遊戲掌機：Acer Nitro Blaze 7，搭載超微（AMD）Ryzen 8040系列處理器，整體AI算力高達39 TOPS（每秒兆次運算），並具備最高2 TB的儲存空間和16 GB LPDDR5x記憶體。

陳俊聖指出，市面上很多掌機，宏碁掌機強調的是散熱，因為放在手中，愈玩愈燙，如何在晶片發展效能時，兼顧散熱，此也是宏碁電競產品設計重心的延伸。

至於AI PC，宏碁此次是推出全系列Copilot+ PC，包括搭載英特爾（Intel）、AMD及高通（Qualcomm）的各產品線，其中包括領先業界推出小於1公斤的Copilot +PC：TravelMate P6 14 AI。

陳俊聖指出，2025年AI PC隨著半導體製程演進，將達40%滲透率，在軟體與硬體搭配下，可望出現上升螺旋效應，互相拉抬，然相較於大家講AI，宏碁要強調的是人本智慧（Human intelligence）。

他表示，在眾人關注TOPS到多少時，宏碁更關注如何運用。宏碁子公司唯晶科技發表全新的GenMotion.AI應用軟體，可利用AI將文字提示生成3D遊戲動畫，可提供給專業動畫師和遊戲製作設計使用。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

宏碁公布Acer Iconia X12平板電腦，搭載聯發科Helio G99處理器、12.6吋2.5K OLED螢幕

2024-09-05 / Cool3c / Chevelle.fu

<https://www.cool3c.com/article/223841>

宏碁算是少數持續推出Android平板的PC品牌，在IFA公布使用聯發科Helio G99處理器的12.5吋大螢幕平板，主打可選配觸控筆、藍牙鍵盤與平板電腦保護支架等配件提供生產力與創造力，也適合遊戲娛樂。

Acer Iconia X12搭載12.6吋2,560x1,600的60Hz螢幕、聯發科Helio G99處理器與8GB RAM+256GB儲存，內建4揚聲器，並可選配的鋁製觸控筆、多角度支架保護殼（含觸控筆插槽）以及附觸控板的可拆式藍牙鍵盤，提高生產力及創造力，進而大幅增加裝置的實用性。Iconia X12亦配備800萬畫素前鏡頭和1300萬畫素主鏡頭，搭配閃光燈和自動對焦功能，電池容量達10,000mAh，可提供出色的續航力。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

宏碁推出搭載Intel Core Ultra 200V系列的Swift 14 AI與Swift 16 AI，還有商務機型TravelMate P6 14 AI

2024-09-05 / Cool3c / Chevelle.fu

<https://www.cool3c.com/article/223834>

宏碁Acer在Intel Core Ultra 200V的首發機型包括兩款隸屬Swift系列的Acer Swift 14 AI(SF14-51/T)和Swift 16 AI(SF16-51/T)鋁合金機身輕薄筆電，強調搭載3K OLED螢幕，影片播放續航力長達29小時，此外還有主打僅1公斤的TravelMate P6 14 AI。

宏碁將於台灣時間2024年9月6日率先開放預購Acer Swift 14 AI(SF14-51/T)三款機型，皆採用3K OLED螢幕與Intel Core Ultra 7 258V及Intel Core Ultra 5 226V處理器，內建32GB或16GB RAM及512GB SSD 儲存空間，建議售價為44,900元至49,900元，交機後上網登錄送即享券1,000元。

Acer Swift 14 AI(SF14-51/T)和Swift 16 AI(SF16-51/T)皆採用輕盈的現代化鋁合金機身設計，強調流暢的上蓋轉軸能以單手輕易開啟，同時觸控板的AI活動指示燈會在使用到NPU與Copilot功能時亮起；Acer Swift 14 AI(SF14-51/T)將提供2K與3K兩種解析度的OLED螢幕，Swift 16 AI(SF16-51/T)則提供單一3K解析度OLED螢幕，皆通過EyeSafe 2.0護眼認證，兩款機種也將在特定市場提供2K IPS觸控螢幕版本。

Acer Swift 14 AI(SF14-51/T)將提供Core Ultra 7與Core Ultra 5等級處理器，重1.26公斤、搭配65Whr電池；Swift 16 AI(SF16-51/T)提供Core Ultra 9、Core Ultra 7與Core Ultra 5三種等級處理器，重1.5公斤，搭配73Whr電池。兩款機型皆具備兩個Thunderbolt 4介面，並具備Acer AI功能，包括可針對文件進行摘要與回答電腦相關問題的AcerSence，以及針對視訊會議的Acer PurifiedView&nbsp;2.0、Acer PurifiedVoice&nbsp;2.0兩款AI增強會議工具。

Acer TravelMate P6 14 AI為主打14吋1公斤Core Ultra 200V處理器的Copilot+ PC與Intel EVO Edition商務機型，搭載16:10比例的WQXGA+與WUXGA螢幕，佔比達82%，同時通過MIL-STD 810H，觸控板也同樣具備AI標誌提示執行AI應用或使用NPU執行AI運算；Acer TravelMate P6 14 AI處理器提供Core Ultra 7與Core Ultra 5等級，電池為65Wh，重0.99公斤。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

**宏碁推出搭載AMD AI 300系列處理器的Swift 14 AI，以及Qualcomm新款處理器的Swift Go 14 AI**

2024-09-04 / Mashdigi / 楊又肇

<https://mashdigi.com/acer-launches-swift-14-ai-powered-by-amd-ai-300-series-processors-and-swift-go-14-ai-powered-by-qualcomms-new-processors/>

宏碁在Computex 2024期間展示搭載代號「Lunar Lake」的Intel Core Ultra 200V系列處理器，並且與Swift 14 AI採相同機身設計的筆電後，此次也以相同名稱於IFA 2024展前活動推出搭載AMD Ryzen AI 300系列處理器，同時也推出名為Swift Go 14 AI、搭載Qualcomm新款8核心設計Snapdragon X Plus處理器的筆電，藉此擴大「Copilot+ PC」設計產品陣容。

此次推出同樣以Swift 14 AI為稱的筆電，採用AMD Ryzen AI 9 365處理器，並且符合微軟「Copilot+ PC」設計規範，可藉由微軟Copilot服務對應各類人工智慧應用服務，同時也能透過宏碁提供PurifiedView 2.0與PurifiedVoice 2.0兩款人工智慧應用工具強化線上會議體驗，螢幕更採可以180度平攤使用，全機重量僅1.32公斤。

▲採用AMD Ryzen AI 9 365處理器的Swift 14 AI

▲透過宏碁提供PurifiedView 2.0與PurifiedVoice 2.0兩款人工智慧應用工具強化線上會議體驗

而此次同步推出的Swift Go 14 AI，則是採用8核心設計Snapdragon X Plus處理器，同樣符合「Copilot+ PC」設計，並且以輕薄機身設計方便使用者隨身攜帶，本身則採用14.5吋WQXGA解析度螢幕設計，支援120Hz畫面更新率，觸控板同樣搭載可識別Copilot或NPU是否運作的AI指示燈號。

至於今年在Computex 2024期間展示，搭載Intel Core Ultra 200V系列處理器的Swift 14 AI，此次則是同步推出16吋規格機種Swift 16 AI，更標榜連續使用時間最高可達29小時以上，機身同樣以輕薄鋁金屬設計，並且配置高達3K解析度的OLED螢幕，另外也同樣搭載Acer AI應用程式，透過人工智慧應用提升使用效率。

另外，宏碁也強調Swift 14 AI與Swift 16 AI均使用消費後回收 (PCR)塑料，出貨時使用100%可回收包裝，並且通過EPEAT Gold認證。

▲搭載Intel Core Ultra 200V系列處理器的Swift 14 AI與Swift 16 AI

▲Swift 14 AI

▲Swift 16 AI

宏碁預計在9月6日開放搭載Intel Core Ultra 7 258V及Core Ultra 5 226V處理器規格的Swift 14 AI進行預購，建議售價為新台幣44900元起跳。

在此次發表新機中，還包含重量低於1公斤的TravelMate P6 14 AI，同樣符合「Copilot+ PC」設計，並且搭載Intel Core Ultra 200V系列處理器，同樣搭載宏碁人工智慧應用工具與商用功能，另外也符合Intel Evo設計。

TravelMate P6 14 AI搭配提供兩種解析度規格設計的14吋螢幕，機身更符合MIL-STD 810H美國軍規防護設計，更可對應長時間電力使用時間與Wi-Fi 7連接功能。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

華碩 IFA 發表多款搭載全新 Intel 處理器 Copilot+ PC

2024-09-05 / 經濟日報 / 吳凱中

<https://money.udn.com/money/story/11162/8207635>

華碩（2357）於IFA期間發表多項創新技術，宣示對「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」願景的承諾。發表一系列搭載最新Intel Core Ultra處理器的Copilot+ PC新品，包含：Zenbook S 14/ 16、Vivobook S 14、ExpertBook P系列等新世代AI筆電，及ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦，每款產品皆充分釋放Intel Core Ultra處理器潛能，提供最高48 TOPS的NPU算力，展現卓越AI運算效能；並將透過免費更新為Windows 11帶來內建AI功能，享有Copilot+ PC體驗。

Intel是華碩將尖端裝置推向市場的重要夥伴，華碩電腦全球副總裁暨消費產品事業處張仰光表示，最新的Zenbook、Vivobook、ExpertBook筆電和NUC迷你電腦搭載強大的Intel Core Ultra處理器，提供無與倫比的效能，並帶來豐富的AI體驗，幫助使用者充分發揮AI潛力，享受更聰明、更直觀的人機互動。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

華碩揭曉搭載Intel新處理器的「Copilot+ PC」機種，同步推出以全新設計的ExpertBook P5、P1更推出同樣換上Core Ultra 200V系列處理器的ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦

2024-09-05 / Mashdigi / 楊又肇

<https://mashdigi.com/asus-unveiled-the-copilot-pc-model-equipped-with-intels-new-processor-and-simultaneously-launched-the-expertbook-p5-and-p1-with-a-new-design/>

華碩在IFA 2024展前活動揭曉諸多採用Intel Core Ultra 200V系列處理器的「Copilot+ PC」設計產品，包含先前曾在Computex 2024期間展出早期設計的Zenbook S 14、Zenbook S 16，以及Vivobook S 14與換上全新設計的ExpertBook P5、ExpertBook P1，另外更推出同樣換上Core Ultra 200V系列處理器的ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦。

▲Zenbook S 14

此次華碩公布機種，先前曾在Computex 2024期間展示，此次則是配合Intel解禁處理器效能細節後正式對外揭曉。

其中在Zenbook S 14 (UX5406)與Zenbook S 16 (UX5606)，採用先前搭載AMD處理器款式的機身設計，一樣採用高科技陶瓷鋁合金Ceraluminum材質，上蓋也以華碩標誌概念為設計，並且在鍵盤面採用幾何格柵設計，透過2715個CNC加工孔提高氣流與散熱效率，另外同樣搭載3K解析度、120Hz畫面更新率的Lumina OLED螢幕。

▲採用高科技陶瓷鋁合金Ceraluminum材質，上蓋也以華碩標誌概念為設計

▲Zenbook S 14 (UX5406)

而機身也同樣提供完整I/O連接埠，搭配加大尺寸觸控板與更直覺敲擊使用的鍵盤，機身重量僅1.39公斤，建議售價則從1499歐元起跳，並且從即日起開放華碩官網預購，預計在9月6日透過fnac、亞馬遜等通路銷售，台灣市場則預計從9月6日開放預購，而Zenbook S 16 (UX5606)則預計在今年第四季於台灣市場上市。

▲Zenbook S 16 (UX5606)預計在今年第四季於台灣市場上市

對應行動辦公與娛樂需求的Vivobook S 14 (S5406SA)，則僅有1.3公斤重、厚度為1.39公分，同樣以極簡設計、金屬機身打造，並且配置Wi-Fi 7無線連網規格、完整I/O連接埠、16:10顯示比例的3K解析度與120Hz畫面更新率顯示螢幕，以及Harman Kardon認證的Dolby Atmos音訊系統，建議售價則從1299歐元起跳，歐洲市場預計在今年10月上市，台灣市場則預計會在年底推出。

▲Vivobook S 14 (S5406SA)

▲Vivobook S 14 (S5406SA)

▲額外提供16吋設計機種

至於此次推出的新款ExpertBook P系列商用筆電，則推出專業機種ExpertBook P5 (P5405)，以及入門機種ExpertBook P1 (P1403)。

▲定位在專業機種的ExpertBook P5 (P5405)

▲ExpertBook P5 (P5405)

▲強調提供完整的I/O連接埠，並且內建雙SSD插槽等設計

ExpertBook P5 (P5405)採用Intel新款Core Ultra 200V系列處理器，更可配合免費提供使用的ASUS AI ExpertMeet工具對應AI翻譯、AI字幕、輔助會議摘要、AI降噪和商業浮水印等功能，另外也搭載BIOS層級的安全技術、安全開機與可信任平台模組 (TPM)，更與McAfee合作預裝資安防護軟體McAfee+ Premium Individual Unlimited，自2024年9月起可在全球地區免費使用一年。

ExpertBook P5 (P5405)更採回收鋁合金與回收鋼材製作，並且率先在華碩商用筆電產品中使用回收磁鐵材質。

ExpertBook P1 (P1403)則採用前一代處理器規格，同樣採用14吋螢幕設計，相比ExpertBook P5 (P5405)將以999美元起跳價格銷售，僅以599美元起跳價格提供，而兩款商用筆電都會在今年10月進入市場銷售。

▲ExpertBook P1 (P1403)採用前一代處理器規格，同樣採用14吋螢幕設計

▲價格設定在999美元區間

此次同步展示的ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦，其實在今年Computex 2024也曾亮相，主要確認採用Intel Core Ultra 200V系列處理器，並且能在僅不到0.6公升、高度僅3.4公分的機身內提供充足人工智慧運算能力，更強調無須工具即可拆卸進行硬體升級，甚至能在嚴苛環境正常運作使用，標榜能對應各類商用或邊緣運算使用需求，甚至也能作為開發工具使用。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

華碩於 IFA 發表多款搭載全新 Intel 處理器的 Copilot+ PC，強化 AI 運算效能

2024-09-05 / 點子科技 / KISPLAY

<https://www.saydigi.com/2024/09/1436127.html>

華碩在 IFA 推出多款搭載最新 Intel Core Ultra 處理器（系列 2）的 Copilot+ PC，包括 Zenbook S 14/16、Vivobook S 14、ExpertBook P 系列等智慧筆電，以及 ASUS NUC 14 Pro AI 迷你電腦。這些產品充分發揮 Intel Core Ultra 處理器的強大運算能力，提供高達 48 TOPS 的 NPU 算力，並將透過免費更新帶來 Windows 11 的內建 AI 功能，提升 Copilot+ PC 的整體體驗。

華碩電腦全球副總裁暨消費產品事業處負責人張仰光表示：「最新的 Zenbook、Vivobook、ExpertBook 筆電與 NUC 迷你電腦，搭載強大的 Intel Core Ultra 處理器，能幫助使用者充分發揮 AI 潛力，提供更流暢、直觀的人機互動體驗。」

Intel 執行副總裁 Michelle Johnston Holthaus 也表示：「Intel 與華碩攜手合作，推出搭載 Intel Core Ultra 處理器的筆電，不僅提供強大效能與更長的電池續航力，還強化資安與 AI 技術，為使用者設立全新標準。」

Zenbook S 系列：精密設計與強大效能的結合

全新 Zenbook S 14 (UX5406) 重新定義了輕薄筆電，將精美設計與卓越效能相結合。14 吋的機身僅 1.1 公分厚、重 1.2 公斤，機蓋採用陶瓷鋁合金材質，更具耐用性。鍵盤面設有 2,715 個 CNC 散熱孔，有效增強散熱效果，發揮最佳運行性能。

這款筆電搭載 Intel Core Ultra 處理器，NPU 算力高達 47 TOPS，配合 3K 120 Hz 的 ASUS Lumina OLED 螢幕，視覺效果亮麗。AI 降噪功能確保線上會議的音質清晰，搭配 FHD AiSense 紅外線攝影機，增強視訊效果。此外，72 Wh 電池提供長效續航，完整 I/O 連接埠與隱私安全功能滿足行動辦公需求。Zenbook S 14 將於 9 月 6 日起開放預購，另有 16 吋的 Zenbook S 16 版本預計於第四季上市。

Vivobook S 14：極簡設計與強大效能的結合

ASUS Vivobook S 14 (S5406SA) 針對行動辦公與娛樂使用設計，機身僅 1.3 公斤、厚度僅 1.39 公分，輕薄易攜。它搭載 ASUS IceCool 散熱技術，配有兩個 97 葉片的 IceBlade 風扇與雙通風口，即使在高負載下也能保持最佳效能。該筆電最高搭載 Intel Core Ultra 7 處理器，並擁有 47 TOPS 的 NPU 算力，支援高效 AI 應用。專屬的 Copilot 按鍵讓使用者可輕鬆啟動 AI 智慧助手。75 Wh 電池提供高達 22 小時的續航，確保全天生產力。

Vivobook S 14 採用人體工學設計，提供舒適的使用體驗。搭載 WiFi 7、3K 120 Hz 螢幕以及 Harman Kardon 認證的 Dolby Atmos 音效系統，讓工作與娛樂兼具。此款筆電預計於年底在台灣上市。

ASUS ExpertBook P 系列商用筆電：AI 提升工作效率

ASUS ExpertBook P 系列針對企業客戶與專業人士設計，提供進階 AI 功能。旗艦款 ExpertBook P5 (P5405) 搭載 Intel Core Ultra 處理器，整合 ASUS AI ExpertMeet 工具，支援 AI 翻譯、字幕、會議摘要、降噪等功能，顛覆線上會議模式。該筆電 NPU 算力可達 47 TOPS，平台總算力高達 120 TOPS，能有效執行各類 AI 應用程式。

此系列產品亦提供多層資安防護，包括安全開機與可信任平台模組（TPM）。此外，與 McAfee 合作，提供一年免費的 McAfee+ Premium 資安軟體。

ASUS NUC 14 Pro AI 迷你電腦：小巧卻強大的 AI 解決方案

ASUS NUC 14 Pro AI 是一款精巧的迷你電腦，搭載 Intel Core Ultra 9 處理器，具備高達 120 TOPS 的總算力，NPU 算力達 48 TOPS，性能是前代的三倍。僅 0.6 公升的機身設計，適合商業與邊緣運算等多樣應用場景。該設備支持全天候運作，並符合 EPEAT Climate+ 標準，擁有指紋辨識與 TPM 等安全功能，提供出色的資安保障。ASUS NUC 14 Pro AI 提供語音操作與遠端控管模式，方便管理與操作，適合在嚴苛環境中使用。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

華碩推出Zenbook S14、Vivobook S14等搭載Core Ultra 200V系列的消費級Copilot+ PC

2024-09-05 / Cool3c / Chevelle.fu

<https://www.cool3c.com/article/223842>

華碩於Intel的IFA 2024 Core Ultra 200V系列處理器發表會後，也公布多款搭載Core Ultra 200V系列的消費級筆電，其中主打採用全新微縮設計主機板、媲美13吋機型但效能不妥協的Zenbook S 14(UX5406)，以及具有高質感且可達22小時續航力的Vivobook S14(S5406SA)兩款重點產品。

Zenbook S 14(UX5406)將在2024年9月6日於台灣開放預購，Zenbook S 16(UX5606)以及Vivobook S 14(S5406SA)預計於2024年第四季上市

Zenbook S 14(UX5406)藉由主機板微縮設計實現出色的輕薄美型機型，相較前一代Zenbook 14吋機型的主機板縮減27%面積，並在等同13吋機型的尺寸提供高性能，實現重量僅1.2公斤、厚1.1公分的設計，上蓋由陶瓷鋁合金與華碩30周年標誌構成，兼具陶瓷的溫潤觸感與鋁的強度，C件則透過2,715個CNC散熱孔兼具美型與空氣對流，搭配雙風扇散熱器使處理器維持寧靜、高效能。

Zenbook S 14(UX5406)搭載Core Ultra 200V系列處理器，配備3K 120Hz ASUS Lumina OLED螢幕，可使FullHD AiSense紅外線攝影機支援AI增強效果，並搭配72Wh電池，在新一代平台加持下相較使用第一代Core Ultra的Zenbook 13高出1.68倍的電池續航力，也同時具備更出色的整體效能。

Vivobook S 14(S5406SA)主打全金屬纖薄機身，重僅1.3公斤、厚1.39公分，利用ASUS IceCool的雙97葉片風扇散熱架構使處理器能達到35TDP效能，搭配75Whr電池續航力最高可達22小時。

Vivobook S 14(S5406SA)採用人體工學設計，具備單區RGB背光ErgoSense鍵盤與大型觸控板，螢幕為16:10 3K 120Hz OLED螢幕，並具備Harman Kardon認證的Dolby Atmos揚聲器。

另外，華碩也展示兩款隸屬Vivobook的翻轉二合一筆電Vivobook 14 Flip(TP3407)與Vivobook 16 Flip(TP3607)，皆採用Core Ultra 200V系列處理器，其中Vivobook 14&nbsp;Flip為FullHD NanoEdge觸控螢幕，Vivobook 16 Flip為16吋3K OLED螢幕。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

華碩IFA發表Copilot+ PC新品　搭載Intel Core Ultra系列處理器

2024-09-05 / 壹蘋新聞網 / 趙筱文

<https://tw.nextapple.com/finance/20240905/A99F2AD68E18E489AF7E423F8FC6B2DA>

華碩在IFA 2024發表了一系列搭載Intel Core Ultra處理器（系列2）的新產品，展現其在「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」願景下的技術創新。這些新品包含Zenbook、Vivobook、ExpertBook系列AI筆電及ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦，每款產品皆擁有卓越的AI運算效能，並將透過Windows 11更新帶來Copilot+ PC體驗。

華碩在IFA 2024發表一系列搭載Intel Core Ultra處理器（系列2）的新產品。華碩提供

Zenbook S系列主打輕薄與效能兼備，Zenbook S 14 （UX5406）以極致輕薄設計吸引眾人目光，僅1.1公分厚、1.2公斤重，外殼採用陶瓷鋁合金，兼具美觀與耐用性。搭載Intel Core Ultra處理器，並提供47 TOPS的AI算力，配備3K 120 Hz OLED螢幕及72 Wh電池，適合長時間的行動辦公需求。Zenbook S 16 (UX5606)也將於第四季上市，提供更大螢幕選項。

輕便且效能強大的Vivobook S 14則是專為行動辦公和娛樂打造，重量僅1.3公斤，厚度1.39公分。最高搭載Intel Core Ultra 7處理器及AI引擎，提供卓越的AI運算能力。75 Wh電池帶來長達22小時的續航力，適合全天候生產力需求，並具有WiFi 7、Dolby Atmos音效等功能，預計年底上市。

專為企業和專業人士設計的ExpertBook P系列筆電，搭載最新Intel Core Ultra處理器和ASUS AI工具，提供包括AI翻譯、AI降噪等功能，提升線上會議效率。該系列也注重資安，與McAfee合作提供一年免費的資安防護軟體。旗艦型ExpertBook P5 (P5405)採用回收材料，體現永續發展承諾，並將於2025年擴展至桌機和一體機。

迷你卻強大的AI運算裝置ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦，體積不到0.6公升，卻搭載Intel Core Ultra 9處理器，提供120 TOPS的總算力，適合物聯網及邊緣運算應用。該設備還具備智能散熱技術、全天候運作能力，並符合資安及能源效率標準，成為各種AI解決方案的理想選擇。

華碩電腦全球副總裁暨消費產品事業處張仰光表示：「最新的Zenbook、Vivobook、ExpertBook筆電和NUC迷你電腦搭載強大的Intel Core Ultra處理器，提供無與倫比的效能，並帶來豐富的AI體驗，幫助使用者充分發揮AI潛力，享受更聰明、更直觀的人機互動。」

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

華碩公布搭載Core Ultra 200V平台的ASUS ExpertBook P5商用筆電與ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦

2024-09-05 / Cool3c / Chevelle.fu

<https://www.cool3c.com/article/223843>

華碩藉IFA 2024公布商用產品新系列ASUS ExpertBook P系列，其中旗艦機型ASUS ExpertBook P5為採用Core Ultra 200V與具備雙M.2插槽的高階AI PC商務筆電，並支援ASUS AI ExpertMeet工具，透過AI翻譯、AI字幕、輔助會議摘要、AI降噪和商業浮水印等功能；另外曾在Computex亮相的新一代NUC迷你電腦也正式冠上ASUS NUC 14 Pro AI的名稱。

ASUS ExpertBook P系列為華碩商用ASUS ExpertBook系列當中的新分支，著重AI與商用筆電的結合，並與McAfee合作，在ASUS ExpertBook P系列商用筆電預先安裝資安防護軟體McAfee+ Premium Individual Unlimited，全球自2024年9月起可免費使用一年。此外華碩也預計將Expert B系列擴展到桌機與AIO電腦。

其中ASUS ExpertBook P5(P5405)不僅搭載Intel Core Ultra 200V提供AI增強體驗，在具備提供30W TDP模式的高效能散熱器之餘還保有M.2 2280+M.2 2230雙SSD插槽，同時支援ASUS AI ExpertMeet工具，螢幕則是使用2.5K 144Hz的LCD螢幕，續航力長達28小時，鍵盤也因應商務會議需求具備視訊會議功能相關的快捷鍵。此外還提供搭配第13代Core平台的ASUS ExpertBook P1(包括14吋與16吋)等機型，在相同的設計風格、可靠性提供更平價的選擇。

ASUS NUC 14 Pro AI已先在Computex 2024默默亮相，代號為Lunar Cayon，搭載最高Core Ultra 9等級的Core Ultra 200V處理器，採用智慧散熱技術，提供24/7的全天運作，並在機身正面具備Copilot快捷鍵，機身小於0.6公升、高僅3.4公分，但仍具備包括Thunderbolt 4、2.5G LAN等豐富的I/O介面，以及Wi-Fi 7與藍牙5.4等無線連接技術。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

華碩IFA秀AI筆電 發表多款Copilot+ PC新品

2024-09-05 / MoneyDJ

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=05cf9778-6e05-4bc2-8ac1-8ee07db02f4c&c=MB07>

華碩(2357)今(5)日表示，華碩於柏林消費性電子展(IFA)期間發表多項創新技術，宣示對「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」願景的承諾；發表一系列搭載最新Intel Core Ultra處理器(系列2)的Copilot+ PC新品，包含Zenbook S 14/ 16、Vivobook S 14、ExpertBook P系列等新世代AI筆電，及ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦，每款產品皆充分釋放Intel Core Ultra處理器潛能，提供最高48 TOPS的NPU算力，展現卓越AI運算效能；並將透過免費更新為Windows 11帶來內建AI功能，享有Copilot+ PC體驗。

Intel是華碩將尖端裝置推向市場的重要夥伴，華碩電腦全球副總裁暨消費產品事業處張仰光表示：「最新的Zenbook、Vivobook、ExpertBook筆電和NUC迷你電腦搭載強大的Intel Core Ultra處理器，提供無與倫比的效能，並帶來豐富的AI體驗，幫助使用者充分發揮AI潛力，享受更聰明、更直觀的人機互動。」

Intel執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus表示：「Intel與華碩為提升消費者和商用產品體驗攜手合作，推出搭載Intel Core Ultra處理器的華碩筆電，不但提供頂尖效能、更長電池續航力、周全的資安和尖端AI功能。從生產力到創意，這些產品為各個領域的使用者體驗設立了全新標準。」

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

華碩IFA新技術發表　攜手Intel開創卓越AI效能

2024-09-05 / ETtoday / 蘇晟彥

<https://www.ettoday.net/news/20240905/2810968.htm>

華碩於IFA（柏林消費電子展）期間發表多項創新技術，宣示對「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」願景的承諾。發表一系列搭載最新Intel® Core™ Ultra處理器 (系列2) 的Copilot+ PC新品，包含：Zenbook S 14/ 16、Vivobook S 14、ExpertBook P系列等新世代AI筆電，及ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦，每款產品皆充分釋放Intel® Core™ Ultra處理器(系列2)潛能，提供最高48 TOPS的NPU算力，展現卓越AI運算效能；並將透過免費更新為Windows 11帶來內建AI功能，享有Copilot+ PC體驗。

Intel是華碩將尖端裝置推向市場的重要夥伴，華碩電腦全球副總裁暨消費產品事業處張仰光表示：「最新的Zenbook、Vivobook、ExpertBook筆電和NUC迷你電腦搭載強大的Intel® Core™ Ultra處理器，提供無與倫比的效能，並帶來豐富的AI體驗，幫助使用者充分發揮AI潛力，享受更聰明、更直觀的人機互動。」

Intel執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus表示：「Intel與華碩為提升消費者和商用產品體驗攜手合作，推出搭載Intel® Core™ Ultra處理器(系列2)的華碩筆電，不但提供頂尖效能、更長的電池續航力、周全的資安和尖端AI功能。從生產力到創意，這些產品為各個領域的使用者體驗設立了全新標準。」

Zenbook S系列：完美結合精密工藝與極致效能

全新Zenbook S 14 (UX5406)重新定義輕薄筆電，將精緻設計與卓越效能融為一體。14吋輕薄美型機身僅1.1公分，1.2公斤，外蓋採用高科技陶瓷鋁合金(Ceraluminum™)製成，結合陶瓷溫潤觸感與鋁的強度，更加堅固耐用。鍵盤面的幾何格柵設計具備2,715個CNC加工散熱孔，使氣流和散熱達到最佳化以發揮優異效能。

憑藉Intel® Core™ Ultra處理器(系列2)的強大效能，NPU最高47 TOPS，成就非凡AI體驗。配備3K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕，視覺效果令人驚艷，四揚聲器音效系統帶來劇院級音訊體驗。AI降噪確保清晰的線上會議音質，FHD AiSense紅外線攝影機支援AI效果以加強視訊互動。長效的72 Wh電池、無縫連接的完整 I/O 連接埠，以及先進的隱私安全功能，滿足行動辦公需求。加大的16:10觸控板結合直覺的智慧手勢，輕鬆調整亮度、音量及影音控制。Zenbook S 14 (UX5406)將於9/6中午開放預購；另有16吋Zenbook S 16 (UX5606)，同樣輕薄美型，預計Q4在台上市。

Vivobook S 14：極簡設計效能超群

專為行動辦公和娛樂而設計的ASUS Vivobook S 14 (S5406SA) ，全金屬纖薄機身僅1.3 公斤、1.39公分，極簡設計輕薄便攜。採用ASUS IceCool散熱技術，兩個97葉片的 IceBlade風扇和兩個通風口，最大TDP為35 W，即使在嚴苛的工作負載下也能保持最佳效能。最高配備Intel® Core™ Ultra 7處理器(系列2)和NPU 47 TOPS的AI引擎，高效執行AI應用程式表現極為出色。專屬Copilot按鍵一鍵啟動AI智能助手，75 Wh電池帶來最高22小時續航電力，以確保全天生產力。

採用人體工學設計，長時間使用依舊舒適，包括可自訂單區RGB背光的ASUS ErgoSense鍵盤，以及可精準操控的超大尺寸觸控板。超快的WiFi 7連線速度、完整I/O連接埠、16:10 3K 120 Hz螢幕以及Harman Kardon認證 Dolby Atmos®音訊系統，在工作與娛樂中取得完美平衡。ASUS Vivobook S 14預計年底在台上市，敬請期待。

ASUS ExpertBook P系列商用筆電：AI加速工作效率

華碩推出ASUS ExpertBook P系列商用筆電，滿足企業客戶與專業人士更進階AI運算需求。其中，旗艦級ASUS ExpertBook P5 (P5405)配備先進的Intel® Core™ Ultra處理器(系列2)，並整合最新ASUS AI ExpertMeet工具，透過AI翻譯、AI字幕、輔助會議摘要、AI降噪和商業浮水印等功能，徹底改變線上會議模式，帶來無與倫比的AI工作體驗，

在Intel最新處理器加持下，ASUS ExpertBook P5 (P5405)最高提供NPU 47 TOPS和平台總算力120 TOPS，可最佳化執行當代AI應用程式。系列中亦有ASUS ExpertBook P3 (P3405/P3605)供選擇，同樣效能極佳、耐用可靠。

針對企業最重視的資安防護，ASUS ExpertBook P系列商用筆電提供延伸至BIOS層級的多層安全性，包括安全開機和可信任平台模組(TPM)等，以防止開機時未經授權的介入。華碩也與McAfee合作，在ASUS ExpertBook P系列商用筆電預先安裝資安防護軟體McAfee+ Premium Individual Unlimited，全球自2024年9月起可免費使用一年。

ASUS ExpertBook P系列結合強大功能與簡約美學，在維持絕佳效能的同時，體現華碩對永續發展的承諾。ASUS ExpertBook P5 (P5405)採用回收鋁合金和回收鋼材，大幅減少環境衝擊，並率先在華碩商用筆電中使用回收磁鐵。未來此系列將拓展至桌機和All-in-One電腦，預計於2025年推出，敬請期待。

ASUS NUC 14 Pro AI迷你電腦：精巧強大

全新ASUS NUC 14 Pro AI 在 AI NUC 迷你電腦技術上擁有令人驚豔的突破性進展，其搭載最新 Intel® Core™ Ultra 9處理器(系列2)，多架構CPU、GPU 和NPU配置，以實現高達 120 TOPS的總算力，其中NPU亦顯著提升 AI 運算至 48 TOPS，為前代處理器的三倍！

ASUS NUC 14 Pro AI 容量不到 0.6 公升，機身高度僅 3.4公分，除能有效節省空間，另具備無與倫比的超高性能，相當適合商業及邊緣運算等多元應用；而倍增的算圖能力，搭配創新的嵌入式LPDDR5x設計，將為各種物聯網情境帶來絕佳的運作表現和穩定性。

可24/7全天候運作的ASUS NUC 14 Pro AI，內建出色的智能散熱技術，並符合EPEAT Climate+能源效率標準，再加上安全啟動、指紋辨識與高信賴平台模組(TPM)等功能，資安隱私有保障。全新ASUS NUC 14 Pro AI的喇叭及麥克風均支援語音操作；獨家遠端控管模式和微軟的Windows Autopilot亦可大幅簡化設備調整、調度流程。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

華碩推出多款搭載最新Core Ultra 商用筆電與新一代NCU AI迷你電腦

2024-09-05 / 鉅亨網 / 吳承諦

<https://m.cnyes.com/news/id/5708142>

華碩 (2357-TW) 在 IFA 開展前舉辦全球發表會，並推出多款搭載 Intel (INTC-US) 最新 Core Ultra 處理器的 AI PC 新品，涵蓋消費級、商用及小型電腦多個領域，另外也釋出多個 AI 助理軟體，搶占 AI PC 市場。

新品陣容包括超輕薄的 ZenBook S 14 OLED 筆記型電腦、主打商務應用的 ExpertBook P 系列，以及專為 AI 設計的 NUC 小型電腦，華碩表示，新產品均具備強大的 AI 運算能力，可滿足不同用戶的需求。

在 AI 功能方面，華碩介紹了 ExpertBook P 系列搭載的 AI Expert Meet 會議助手軟體，可實現即時會議記錄、翻譯及摘要；華碩還與 McAfee 合作開發深度偽造檢測技術，利用 Intel NPU 在本地進行 AI 影音內容真實性驗證。

此外，華碩新一代 NUC 迷你電腦採用獨家智慧散熱技術，確保 AI 應用長時間高效運行，新產品不僅在性能上有所突破，在環保及永續性方面也有進展，如採用可回收材料、提高能效等。

華碩西歐、中東及非洲地區總經理 William Huang 表示，此次新品發布標誌著華碩與 Intel 在 AI PC 領域的深度合作，將為用戶帶來更智慧、高效的運算體驗。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

Copilot+ PC 陣容添新成員，AMD Ryzen AI 300、Intel Core Ultra 200V 入列

2024-09-04 / 科技新報 / 陳冠榮

https://ccc.technews.tw/2024/09/04/copilot-plus-pc-expand-availability-with-new-amd-and-intel-silicon/

除高通 Snapdragon X 系列處理器外，已經上市的 AMD Ryzen AI 300、最新發表的 Intel Core Ultra 200V 皆成為符合 Copilot+ PC 條件的處理器，搶攻 AI PC 市場獲得最大助力。

AMD 宣布搭載 Ryzen AI 300 處理器的筆電產品將在今年 11 月系統免費更新後成為 Copilot+ PC，提供如回顧（Recall，備受爭議下 10 月才開放測試）、Cocreator、即時字幕（Live Captions）、Windows 工作室效果（Windows Studio Effects）等支援 AI 的功能。

第三代 Ryzen AI 處理器 Ryzen AI 300 系列配備最高 12 個高效能 Zen 5 核心和 24 個執行緒，更搭載 50 TOPS 以上 NPU，可有效處理 PC 端 AI 工作負載、生成式內容及自動化工作流程，提高生產力。

像是華碩已有多款搭載 Ryzen AI 300 系列（如 AMD Ryzen AI 9 HX 370）筆電在台上市銷售，其他大廠也將陸續開賣這款處理器的筆電。

▲ 華碩 Zenbook S 16 已在 7 月底開賣。（Source：科技新報）

不只如此，微軟也宣布英特爾最新發表 Intel Core Ultra 200V 系列也將成為符合 Copilot+ PC 條件的處理器，同樣在 11 月系統免費更新後獲得新的 AI 體驗。

為了推廣專為 AI 設計的全新 Windows PC，微軟推出 Copilot+ PC，定義出這種 PC 至少需要 16GB 記憶體、256GB SSD 同時整合 NPU，達到 40 TOPS 以上、可存取最先進 AI 模型，具備全天電池續航力。

Copilot+ PC 一開始僅適用於搭載高通 Snapdragon X Elite 和 Snapdragon X Plus 處理器的產品，包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、三星及微軟自家 Surface 都有產品銷售。未來加入 AMD Ryzen AI 300 和 Intel Core Ultra 200V，將有更多新機壯大 Copilot+ PC 陣容。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

微軟證實從今年11月開始，搭載Intel、AMD新款筆電處理器的筆電也能被稱作「Copilot+ PC」原本僅由Qualcomm獨佔使用名稱

2024-09-04 / Mashdigi / 楊又肇

<https://mashdigi.com/microsoft-confirmed-that-starting-from-november-this-year-laptops-equipped-with-new-laptop-processors-from-intel-and-amd-can-also-be-called-copilot-pcs/>

隨著Intel於IFA 2024展前活動正式宣布代號「Lunar Lake」的新一代Core Ultra筆電處理器正式推出，而相關應用產品也將從即日起開放預購，預計在9月24日陸續銷售，微軟Windows及裝置負責人Pavan Davuluri也在活動上宣布包含搭載Intel新款處理器，以及AMD日前推出Ryzen AI 300系列處理器的筆電產品，都能在今年11月開始陸續加入Copilot+ AI功能，進而成為微軟定義的「Copilot+ PC」產品。

如此一來，原本僅由Qualcomm獨佔使用的「Copilot+ PC」產品名稱，接下來也能在Intel、AMD新款處理器應用產品上看見，並且同樣能使用諸多「Copilot+ PC」產品應用功能，包含以人工智慧產生的即時翻譯字幕功能，或是以人工智慧驅動的自動圖像生成功能，甚至也包含視訊會議中的背景模糊、目光居中與自動取景等常見功能。

其他功能，更包含目前僅在搭載Qualcomm處理器產品提供使用的自動超解析度 (Auto SR)功能，讓使用者能在遊玩遊戲過程中，以不影響執行效能前提下增加畫面解析度與畫面更新率，達成類似NVIDIA DLSS或Intel XeSS等技術效果。

另外，微軟預計在今年11月開放預覽測試的「Recall」功能，接下來也將能在搭載Intel、AMD新款處理器的筆電裝置上使用。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

平價革命，PC 正在流行？

2024-09-04 / 科技新報 / 朱熹

<https://technews.tw/2024/09/04/affordable-pc/>

以往在 PC 產業，往往只有那些規格最頂的才能吸引市場的注意，所以在 CES 或 COMPUTEX 時常可以看到廠商推出了規格超高、效能超好的旗艦機種吸引目光。然而這樣的態勢到了 2024 卻有所改變，縱使還是有廠商願意推出這樣的機種，但市場上的注意力卻漸漸移到價格較平易近人的機種，究竟是為什麼？

追根究底，主要還是因為產品資訊更加透明，以及各廠家意識到價格也能成為賣點。在以往產品資訊流通不甚順暢的情況下，往往只有規格最高最吸睛的產品，其資訊才有機會被投射至消費者。除了本身的規格就是賣點，廠商也比較願意為高單價的產品投注行銷資源；但現在產品資訊異常透明，不只傳統媒體，新興的自媒體更是讓產品資訊傳播迅速。消費者隨手一key便能獲取產品資訊，即便是那些比較入門且廠商不會投注太多行銷資源的機種。

不只新媒體的興起讓原本名不見經傳的產品資訊也能流通，媒體也開始意識到雖然規格超高價格超貴的產品可以短暫吸引讀者的目光，但事實是能購買這些產品的消費者不多，潛在的閱聽眾自然也少；反而是平價產品的潛在消費者多，再加上現在的消費者在購物前多會花時間研究產品或是規格，結果就是平價機種的閱聽量不輸甚至超過旗艦機種，媒體們自然更願意報導。

除了產品資訊更加透明，廠商也意識到價格可以成為最佳的行銷武器。即便強勢品牌如蘋果，每次在宣傳自家的MacBook Air系列時都拿相對便宜的入手價為號召。即便市場發現如果升級至堪用的規格後價格不甜，聲量也已經有所累積；今年五月推出的Copilot+ PC亦是另一個最經典的案例：微軟和高通不斷強調Copilot+ PC起跳價999美金，高貴不貴；微軟自家推出的Surface Laptop更是因為其精緻的作工和極具競爭力的價格成功打開市場，並廣被認為是真正的MacBook Air殺手。

另一個血淋淋的例子就是AMD的Strix Point處理器。其擔任全新Zen 5架構的第一棒，更是x86陣營第一顆符合Copilot+ PC規範的處理器，再加上評測結果在效能以及能耗表現上亦廣受好評，理論上討論度不低，然而實際狀況是撇開華碩在發表搭載Strix Point的ZenBook初期投入的曝光，市場上並無太多討論。原因無他，就是因為Strix Point本身定位較高，即便搭載Strix Point的ZenBook在面對眾搭載Snapdragon X的Copilot+ PC表現毫不遜色，效能上更是力壓對手，但其相對較高的售價也讓多數媒體在下結論時有所保留，更何況AMD在中高階市場是新面孔，眾多因素交雜下也讓Strix Point雷聲大雨點小，市場目光還是多留在Arm陣營的Copilot+ PC。

PC產業確實正在上演一齣平價革命，PC產業常說產品最重要的就是規格和價格，但對市場來說，顯然現在是一個價格先決的時代，想要奪得市場目光，價格不夠親民，規格再好也是乏人問津。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

MSI發表全新世代AI＋ 電競與商務筆電 同步搶先在台上市

2024-09-05 / 工商時報 / 吳俊儀

<https://www.ctee.com.tw/news/20240905700645-431207>

MSI 微星科技在 IFA 2024 發表全新世代 AI+ 電競與商務筆電，並同步在台灣上市。這次推出的筆電搭載最新的 Intel Core Ultra 處理器 (Series 2) 和 AMD Ryzen AI 300 系列處理器，擁有更強大的 AI 運算效能，支援更多 AI 模型、框架與運算元件。

MSI 執行副總裁暨 NB 產品總經理郭緒光 (Eric Kuo) 表示，MSI 提供業界最完整的 AI+ PC 產品線，並歡迎全球媒體與消費者體驗這次的創新電競與商務產品。

這次 MSI 同步推出五款 AI+ 筆電，並將於 2024 年 9 月 6 日起在台灣授權經銷通路開放預購。早鳥活動期間（9 月 6 日至 9 月 29 日）購買，完成產品註冊與登錄，可加贈相片大師 365 一年版（市價 NT$1,500）及 Microsoft 365 個人版一年訂閱（市價 NT$1,790）。

商務筆電部分

MSI 於 IFA 2024 推出全新 Prestige 與 Summit 系列商務筆電，搭載 Intel Core Ultra 處理器 (Series 2)。這些處理器相較前一代，具備高達三倍的 TOPS 算力，結合內顯、CPU 和 NPU，總算力超過 100 TOPS，能夠支持更多 AI 軟體與服務。此外，這些處理器已與超過百家獨立軟體供應商合作進行優化設定，提供更快速且安全的使用體驗。已有超過 500 種 AI 模型針對 Intel Core Ultra 處理器進行最佳化設定，讓這些筆電成為 AI 相關服務的絕佳開發平台。

Prestige 系列提供 13 吋、14 吋與 16 吋選擇，擁有超輕薄設計、大容量電池，續航力最高達 20 小時，並配備 500 萬像素視訊鏡頭，提升直播與會議品質。Summit 13 AI+ Evo 同樣升級搭載 Intel Core Ultra 處理器，機身輕巧且具備企業級資安防護，並支援 MSI Pen 2 觸控簡報筆，成為全方位的翻轉商務筆電。

電競筆電部分

MSI 也推出搭載 AMD Ryzen AI 300 系列處理器的全新筆電，包括 Stealth A16 AI+、Summit A16 AI+、Prestige A16 AI+ 和 Creator A16 AI+。AMD Ryzen AI 300 系列處理器相比前一代處理器，提供高達 2.8 倍的 TOPS 算力，讓生成式 AI 或大型語言模型在筆電上順暢運行。

針對遊戲玩家與創作者設計的 Stealth A16 AI+ 和 Creator A16 AI+ 配備 NVIDIA GeForce RTX 40 筆記型電腦 GPU，機身輕巧，並搭載 Cooler Boost 5 強效散熱系統，讓筆電在輕薄與效能之間取得完美平衡，提供頂尖的 AI 運算能力。

搭載 AMD Ryzen AI 300 系列處理器的 MSI 筆電將於 2024 年 9 月 6 日起開放預購，首波機款包括 Stealth A16 AI+ 電競筆電，以及 Summit A16 AI+、Prestige A16 AI+ 商務筆電。在早鳥活動期間購買並完成註冊，還可享加贈相片大師 365 一年版及 Microsoft 365 個人版一年訂閱。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

微星前往柏林IFA展全面布局AI　跨足充電樁市場

2024-09-03 / 鉅亨網 / 吳承諦

<https://news.cnyes.com/news/id/5706325>

PC 品牌微星 (2377-TW) 將於 9 月 6 日至 10 日在柏林 IFA 2024 展出全系列新品，全面布局 AI 市場，推出多款 AI 產品，並同時首度跨足電動車充電基礎設施領域，推出快速充電樁、旅行充電樁等產品，全面搶攻充電樁市場。

微星行銷副總經理程惠正表示，AI 正快速改變世界，公司將透過創新技術，為各領域用戶提供更智能的體驗。此次展出的新品涵蓋 AI 筆電、智慧顯示器、電競掌機等多個產品線，顯示微星全面擁抱 AI 趨勢的決心。

在 AI 產品方面，微星推出搭載 Intel® Core™ Ultra 處理器（系列 2）的 Prestige 系列 AI 筆電，以及全球首款採用相同處理器的 Windows 11 電競掌機 Claw 8 AI+。此外，公司還展出 Modern AM273Q/QP AI 一體式電腦，搭載 27 吋 WQHD IPS 面板和最新 Intel® Core™ Ultra 處理器，進一步強化其 AI 產品線。

微星首次跨足充電樁市場，推出 MSI Hyper 180 Dual 直流快速充電樁，充電功率高達 180kW，採雙槍設計，支援 CCS1、CCS2、NACS 三種充電標準；公司還推出 Eco 系列三相電智慧充電樁和 EZgo 旅行充電樁，以及 E-Connect 能源管理系統，全面進軍電動車充電基礎設施市場。

微星科技表示，充電樁業務是公司布局智慧城市的重要一環。隨著電動車市場快速成長，相關充電設施需求大增，微星將憑藉其在硬體設計和軟體整合的優勢，為這個新興市場提供全方位解決方案。

此外，微星還展出了 GeForce RTX™ 4070 SUPER 顯示卡、MPG Infinite X3 AI 電競主機、MPG 321CURX QD-OLED 電競螢幕等多項新品，涵蓋電競、創作、商務及 AIoT 等多個領域，展現公司多元化發展的策略。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

三星改手機策略，S系列採高通技術、摺疊機配備 Exynos 晶片

2024-09-03 / 科技新報 / 邱倢芯

<https://technews.tw/2024/09/03/samsung-s25-snapdragon-8-gen-4/>

韓國媒體報導，三星電子決定明年初 Galaxy S25 系列，全面採用高通 Snapdragon 8 Gen 4 晶片，回歸 Galaxy S23 系列全高通晶片策略。

三星 Galaxy 設備長期使用高通與自家 Exynos 晶片組，據不同市場販售不同晶片版，如美國機款使用高通技術，部分國際市場為 Exynos 晶片版。這策略直到 2023 年才變化，三星放棄雙晶片，全球 Galaxy S23 系列都是 Snapdragon 8 Gen 2 版，不過 Galaxy S24 系列又變回雙晶片。

不過現在三星似乎計劃再讓 S 系列回歸全高通晶片。

《Hankyung Korea Market》報導，三星 Galaxy S25 系列僅有 Snapdragon 8 Gen 4 晶片，AI 應用是三星做這決定的關鍵，因要透過最高效能晶片，迎接蘋果與中國品牌在生成式 AI 手機市場的壓力。

市場對三星計畫的傳言褒貶不一，起初傳出會推專為 Galaxy 旗艦機打造的特殊晶片，但最終計畫沒有實現；且傳言稱，即將推出的設備將採 3 奈米 Exynos 晶片，甚至有消息稱三星也考慮採聯發科晶片。

不過三星手機晶片策略變化可能不限 S 系列，也可能改變摺疊設備晶片策略；消息稱，2025 年將推新摺疊手機，可能採用 Exynos 2500 晶片；這是巨大變化，因三星摺疊手機一直是用高通晶片。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

三星S25系列傳配高通S8 Gen 4 摺疊新機可能全用Exynos 2500

2024-09-04 / 手機王 / 布小白

<https://www.sogi.com.tw/articles/samsung_galaxy_s25/6262820>

三星包括 SAMSUNG Galaxy S24 系列、Galaxy Z Fold6 及 Galaxy Z Flip6 等 2024 年推出的旗艦手機，在台灣均搭載高通 Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 行動平台，不過 Galaxy S24、Galaxy S24+ 在部分市場有採用三星 Exynos 2400 的版本。最新消息指出，三星計劃調整 2025 年旗艦機型的處理器部署策略，預計上下半年推出的旗艦手機將會採用不同的處理器配置。

▲SAMSUNG Galaxy S25 系列傳聞全採用高通 Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy。（圖為 SAMSUNG Galaxy S24 系列）

韓國媒體韓京網近日引述業界人士消息，表示取得三星 2025 年旗艦手機的處理器規劃。據透露，SAMSUNG Galaxy S25 系列的三款機型將統一搭載高通 Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy，不再因銷售市場而有所區別。三星此舉目的在於藉由高通處理器的強大性能，進一步鞏固其在 AI 手機領域的領先地位。

▲高通 Snapdragon 8 Gen 4 預計將於 10 月底發表。

來源同時指出，預計 2025 下半年推出的摺疊螢幕手機，包括 SAMSUNG Galaxy Z Fold7 和 Galaxy Z Flip7，將全數搭載三星自家研發的 Exynos 2500 處理器，而不會有高通版本。目前三星電子設備解決方案部門（DS）還正致力於提升 Exynos 2500 的生產良率與性能穩定性；該處理器預計會採用

3nm 製程。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

6.3吋螢幕？vivo X200正面設計模擬圖透露可能的外觀設計

2024-09-04 / 手機王 / 布小白

<https://www.sogi.com.tw/articles/vivo_x200/6262823>

vivo X 系列旗艦手機自 X80 系列起，採用雙曲面的背蓋及螢幕設計，而 2023 年底推出的 X100 和 X100 Pro 也延續這樣的設計風格；不過，日前在網路上流傳的 vivo X200 模型機翻拍照卻顯示，下一代手機可能會改用平面螢幕與平面邊框設計。稍早曝光的 vivo X200 正面設計模擬圖，再次透露其潛在的機身外觀，並流傳部分新機規格。

雖然原始來源已被移除，但備份圖片顯示，vivo X200 採用平面螢幕、四邊等寬的窄邊框設計，音量鍵與電源鍵仍位於機身右側。來源並透露，vivo X200 將會配備 6.3 吋 FHD+「挖孔」OLED 螢幕，採用 LTPO 顯示面板，支援 120Hz 更新率。

根據早前傳聞，vivo X200 將搭載聯發科天璣 9400 處理器，採用光學螢幕指紋辨識技術，電池容量約 5,500~5,600mAh，支援 90W 有線快充。此外，後置三鏡頭系統包括 5,000 萬畫素主相機（Sony 感光元件）、5,000 萬畫素潛望鏡頭與 5,000 萬畫素超廣角鏡頭。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

小米 Xiaomi 15 Ultra 手機相機曝料：主鏡頭升級、2 億像素長焦、10 倍變焦、4K 電影模式， Xiaomi 15 系列已通過認證

2024-09-04 / 電腦王阿達 / Shengti

<https://www.kocpc.com.tw/archives/563342>

小米在手機相機領域的卓越表現，加上與徠卡相機展開合作後，已逐漸成為市場上的一大競爭者，尤其是在其旗艦系列 Xiaomi Ultra 影像歧見的不斷進步下，表現更是令人驚豔。前幾代的 Xiaomi 13 Ultra 和 Xiaomi 14 Ultra 取得了巨大的成功，而現在，Xiaomi 15 Ultra 的消息逐漸浮現，讓人們對這款新手機充滿期待。

根據最新消息，Xiaomi 15 Ultra 的詳細規格已經開始流出，我們將為您帶來目前最完整的相關資訊。這些信息來自知名科技媒體 Smartprix 與知名曝料者 Kartikey 的合作，提供了 Xiaomi 15 Ultra 的獨家消息，以下就簡單整理目前關於 XIaomi 15 Ultra 的相關爆料資訊。

多年來，Sony 與小米在相機技術上展開了多次合作，其中最著名的合作成果之一就是 Sony IMX989，這是一款一英寸型感光元件。如今，兩家公司再次合作，對 Sony LYT-900 感光元件進行升級。這款新感光元件將在現有的 Xiaomi 14 Ultra 所使用的 LYT-900 感光元件基礎上，帶來多項改進，特別是在低光環境下的表現上，預計將有顯著提升。

Xiaomi 15 Ultra 其中一個最令人期待的升級，就是專屬的 4K 電影模式。雖然電影模式在上一代 Ultra 系列手機中已經推出，但當時僅限於 1080p 的解析度。未來，Xiaomi 15 Ultra 將提升至 4K，帶來更加清晰細膩的電影級影片拍攝體驗。  
類似的升級也將應用在慢動作拍攝模式上。這些進步主要歸功於小米的新影像處理晶片，以及即將推出的 Snapdragon 8 Gen 4 所帶來的 ISP（圖像信號處理器）升級。

Xiaomi 15 Ultra 另一項傳聞的重點升級是配備了一個全新的 200MP 長焦鏡頭，並支援 10 倍變焦。相較於目前的 Xiaomi 14 Ultra 提供的 5 種變焦模式（0.5x、1x、2x、3.2x 和 5x），Xiaomi 15 Ultra 預計將增加第六種變焦選項「10 倍變焦」，這主要是透過全新 200MP 長焦鏡頭來實現的。  
目前已經在 vivo X100 Ultra 上看到了類似的 200MP 長焦鏡頭，該鏡頭在中國市場上廣受好評，能夠拍攝出色的照片，現在小米也將此技術導入到其旗艦機型中。

此外，Xiaomi 15 Ultra 預計將配備一個升級版的自拍相機。傳統上，小米在自拍相機方面的表現相對不如其韓國和美國的競爭對手，但小米正努力改變這一現狀。預計 Xiaomi 15 Ultra 將搭載一個 5000 萬像素的自拍鏡頭，相較於 Xiaomi 14 Ultra 的 3200 萬像素鏡頭，將帶來顯著的提升。

除了這些相機方面的升級外，Xiaomi 15 Ultra 還將搭載即將推出的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 處理器，配備 2K 四曲面顯示螢幕，更大的電池容量，並在機身背部採用陶瓷和人造皮革的設計，提升手機的質感和手感。

日前微博的數碼閒聊站也分享已經有 Xiaomi 15 系列的心機通過認證，但目前還無法肯定是哪款機型。

此外，標準版的 Xiaomi 15 預計採用邊框更窄的平面螢幕，數碼閒聊站也釋出了合成圖提供示意：

傳聞 Xiaomi 15 的螢幕邊框最窄只有 1.5mm ，且居中打孔的直徑縮小到 2.5mm 。

至於 Xiaomi 15 Ultra 何時發表呢？這款令人期待的手機預計傳聞將在 2025 年前兩個月於中國正式發佈。隨著新機發表日期的更近，或許網路也會有更多關於這款手機的詳細資訊。

延伸閱讀：  
強效除蟎新利器！小米 Xiaomi 除蟎機全面在台開賣：旋風吸力、紫外線殺菌一次到位，售價 995 元

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

更輕更薄更厲害！OPPO Find N5 傳明年第一季見

2024-09-05 / ePrice / dddd204

<https://www.eprice.com.tw/mobile/talk/4693/5812131/1/>

摺疊手機輕薄化越戰越烈，在榮耀、小米等廠商都打出了超薄厚度之後，當年以 Find N2 主打比 iPhone 14 Pro Max 還要輕的 OPPO，傳聞也將在明年的 Find N5，推出摺疊後不到 10mm 的超薄厚度。

▲ 圖為 OPPO Find N2，號稱首款與常規旗艦同等重量的大摺疊螢幕手機。

摺疊厚度不到 10mm

爆料人數碼閒聊站在微博透露，OPPO 將在明年第一季推出第四代大螢幕摺疊手機 Find N5，並且將會更輕更薄，摺疊後的厚度將不到 10mm，也代表展開厚度僅有 4.xmm，並且以前代 Find N3 的 245 公克重量推測，Find N5 的重量應該不會超過 240 公克。

數碼閒聊站隨後在討論中回覆網友，Find N5 將擁有創紀錄的厚度，目前大螢幕摺疊手機厚度最薄為榮耀 Magiv V3 的摺疊後 9.3mm，代表 Find N5 摺疊後的厚度，可能會非常接近 9mm；另外大螢幕摺疊手機最輕的產品目前則為 vivo X Fold 3 的 219 公克。

OPPO Find N5 不意外的將換上最新的高通 S8 Gen 4 處理器，延續前代 2K+ 解析度的內螢幕、三段式靜音鍵，以及圓形的相機模組設計，搭載了5,000 萬大感光元件主相機的三相機系統，具備一組潛望式長焦相機，並在結構上進行加強，防水能力有機會再提高。

此外數碼閒聊站也提到，OPPO 新系統的競爭力也比較大，看來除了硬體，OPPO 也將在摺疊應用軟體功能上進行強化。前代 Find N3 曾在國際市場推出，並且 OPPO 也宣布 Find X 系列國際市場的回歸，看來 OPPO 將大力推動旗艦商品在全球市場佈局，Find N5 或許也有機會在台灣推出。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

3Q24 全球智慧手機產量微幅回升，但仍呈約 5% 年衰退

2024-09-04 / 科技新報 / TechNews

<https://technews.tw/2024/09/04/global-smartphone-production-rebounded-slightly-in-3q24/>

TrendForce 最新調查，2024 年第二季部分品牌新機鋪貨期結束，加上季底進入庫存調節等因素，全球智慧型手機生產總數落在 2.86 億支，較第一季衰退約 3%。面對旺季不旺的市場趨勢，品牌廠第三季生產規劃普遍趨於保守。因此，第三季生產總數預估僅有微幅季增，達 2.93 億支，但仍較去年同期呈現約 5% 年衰退，並低於疫情前水準。

三星第二季由於Galaxy S24新機鋪貨期結束，智慧型手機產量季減10%，降至5,380萬支，仍維持市占第一。TrendForce表示，三星有望於第三季底推出一款高階薄型摺疊手機，可視為Z Fold6的延伸機。然考量售價與缺乏殺手級應用，薄型款僅占三星摺疊手機1%，對衝刺市占幫助有限。

市占第二的蘋果於第二季生產約4,410萬支智慧型手機，雖季減8%，但較2023年同期成長5%，可視為因應中國618電商促銷的先行備貨。中國市場降價策略奏效，帶動第三季生產表現。此外，蘋果9月發表四款新機，2024年新機生產總數將破8,600萬支，較去年增長近8%。

小米（含小米、紅米及POCO）第二季智慧手機生產總數為4,180萬支，年增19%。雖維持樂觀布局策略，考慮需求未顯著回升，第三季生產目標僅中個位數成長，並謹慎監控庫存，避免再次陷入高水位困境。

Oppo（含Oppo、OnePlus及Realme）第二季生產總數年增6%，市占率排名第四。TrendForce表示，中國市場穩定占銷售占比約35%，其次為印度和東南亞地區。展望第三季，Oppo生產目標將與第二季持平。

Vivo（含Vivo及iQoo）得益新品推出及中國市場銷售告捷，第二季智慧手機產量季增20.5%、年增10.2%，市占率排名第五。Vivo近年雖積極開發海外市場，但中國市場仍占銷售市占50%。TrendForce預估第三季生產總數可望與第二季持平。

TrendForce指出，Transsion（含TECNO、Infinix及itel）第一季產出過於積極，造成通路庫存上升，第二季為調節庫存，下調生產總數至2,360萬支，季減20.8%，市占排名退後一位至第六名。進入第三季，Transsion同樣以維穩第二季的生產表現為主，避免重蹈庫存升高的壓力。

全球性經濟疲軟同樣衝擊高銷售成長潛力的南美、中東和非洲等市場，加上多個手機品牌進軍，開始出現僧多粥少的局面。近期這些新興市場有整機通路庫存升高的現象，品牌廠因此更注意零組件和整機庫存管理，避免因庫存高過而加劇金流壓力。在此背景下，品牌廠對下半年的生產計劃普遍採取保守態度，以因應需求的不確定性。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

全球Q2入門手機TOP10出爐 小米/三星/OPPO各分3席

2024-09-04 / MoneyDJ

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=11c8e03f-3d4f-484c-b69a-8c85c3ec5d24&c=MB07>

IT之家報導，據Counterpoint Research昨(3)日發布報告顯示，今(2024)年第2季受新興市場推動，全球經濟型智慧手機銷量突破1億支、年增10%，占全球智慧手機銷量的37%。在經濟型細分市場中，第2季最暢銷的前10款經濟型智慧手機達到四分之一，高於去年同期的 21%。

而第2季活躍的經濟型智慧手機型號數量減少至略高於1,500款，與2018年同期相比減少了近一半，此趨勢凸顯了隨著原始設備製造商專注於更精簡的產品組合，以及消費者更青睞知名品牌，經濟型細分市場正在進行整合。

數據顯示，第2季十大經濟型智慧手機排行榜被小米(1810.HK)、三星(Samsung)和OPPO所占據，各占三席，剩下的一個名額被傳音(688036.SH)旗下TECNO占據。其中，最暢銷的經濟型智慧手機是小米紅米13C 4G，其次是三星Galaxy A05和A15 4G。

此外，經濟型智慧手機市場正在經歷向5G的明顯轉變，第2季5G設備將占24%的市場份額，年增長率為2.5倍。印度和中國是這一增長的主要貢獻者，5G已成為這些市場中經濟型細分市場的標準功能。隨著5G價格越來越親民，150美元以下的細分市場將出現大幅增長，原始設備製造商將把5G作為差異化的關鍵因素。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

研調：今年全球智慧手機出貨量預測上調至12億支

2024-09-04 / MoneyDJ

<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=88cb3587-14f6-4213-a6e2-e5ca836a4ff4&c=MB07>

IT之家報導，據Canalys今(4)日發布《二季度，Canalys智慧手機全方位榜單及預測：AI、高端手機、5G、折疊螢幕》報告指出，今(2024)年第二季全球智慧手機市場景氣度持續提升，儘管增長好於預期，基於成本上漲，庫存週轉，營商環境帶來的挑戰，僅小幅上調今年全球智慧手機出貨量預測至12億支、年增5%。

區域層面來看，新興市場仍是帶動整體市場復甦的重要支柱，但部分市場下半年將面臨宏觀不確定性風險以及競爭的加劇。長期來看，智慧手機市場的年增長率將在今年的強勢反彈後逐步進入平台期，2024年至2028年將以2%的年複合增長率溫和成長。

數據顯示，第二季全球600美元以上機種出貨量前五廠商皆保持年增長。蘋果透過其Apple Intelligence服務的推出重燃市場關注，以62%的份額穩居高端市場首位；三星Galaxy S24需求延續，以22%的份額位居第二；華為在其Pura系列新品的推動下在本土市場延續了強勁的復甦態勢，以9%的份額位列第三；小米(1810.HK)憑借其14系列的持續需求，出貨量位居第四；vivo則位列第五。

此外，Canalys預計，今年AI手機滲透率將達到17%，並且此一數字將在明(2025)年進一步快速成長，來到30%。蘋果仍然是該領域的頭號玩家，其第二季以1,800萬支的出貨規模占據了AI手機51%的市場份額。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

2024 年 8 月手機降價 Top15 ，這些手機降最多！

2024-09-04 / ePrice

<https://m.eprice.com.tw/mobile/talk/102/5812124/1>

隨著蘋果新機iPhone 16系列即將在下周登場，非蘋陣營智慧手機壓力不小，各大品牌持續推出降價優惠，根據傑昇通信統計8月門市手機銷售價格資料，公佈2024年8月降價手機TOP 15排行榜顯示，單機降幅在2%~23%不等，整體總降幅範圍則在7%~28%之間；果粉們關心是否有iPhone降價機型進榜，傑昇通信表示，在新機定價未明朗前，不排除這波價平量縮的現象會持續到新機上市；而本月共七個品牌進榜，消費者可選擇的機型更多，三星Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB）累積總降價金額達12,110元，降幅顯著正是入手的好時機。

iPhone 16系列發表進入倒數，全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信分析，八月整體手機市場受新機效益加持，各品牌在市面上流通的機型不得不降價搏眼球，雖然父親節、七夕情人節帶來的買氣不如預期，然而品牌業者加上通路商，共同釋出的利多，還是吸引不少消費者換機；不過，期待iPhone 15系列大降價的果粉希望落空，八月沒有任何一款iPhone機型進榜，顯見不只果粉出手保守，各通路在新機上市前，價格也有所停滯。

近期隨著Galaxy S25系列的曝光，當前熱銷旗艦三星Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB）也開始有甜甜價，搭載高倍數長焦鏡頭的Galaxy S24 Ultra，還擁有可清晰捕捉低光源的拍攝能力，具備 IP68 防塵防水等級，最引人注目的功能是強大的「Galaxy AI」，以及承諾七年內不斷更新，上市至今總降幅達28%、總降價金額累積12,110元最高，對預算有限又想擁有旗艦規格的消費者而言，此時入手旗艦機正是時候，建議民眾可趁通路打折買起來。

另一款則是累積總降幅近4成vivo V30e（8GB/256GB），有最新自拍神機之稱的V30e，延續V30系列引以為傲的「柔光人像3.0」技術，更配備5,000萬畫素超感光主鏡頭及搭載全台首發台積電（2330）4nm高通驍龍6 Gen 1旗艦處理器，內建5,500mAh電池續航，支援44W極速閃充，電池耐用度可至四年，6.78吋的螢幕，傑昇通信提到，現在空機價格萬元有找，算是同級規格內最低價，此時也是舊機價格最甜蜜的買點，完全可無痛入手。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

|  |
| --- |
| **其他業界重要訊息** |

Intel 展示 Lunar Lake 生產力與遊戲功耗的出色表現

2024-09-04 / XFastest / lin.sinchen

<https://www.xfastest.com/thread-291874-1-1.html>

Intel 新一代 Core Ultra 200V 筆電處理器、代號 Lunar Lake，為 AI PC 時代帶來突破性效能和效率提升，並在全球發表會中實際展示筆電在生產力測試與遊戲時的功耗表現對比。

實際展示中 Intel 使用 Core Ultra 9 288V、Core Ultra 7 258V、HX 370 與 X1E-80-1000 等 4 台筆電，執行 Dota 2 遊戲並記錄 FPS 與功耗表現。

Core Ultra 9 288V 可達到 78 FPS 僅 43.2W 功耗、Core Ultra 7 258V 則是 72 FPS 僅 34.2W 功耗，而比較的 HX 370 則是 63 FPS、47.1W 功耗至於 X1E-80-100 僅只有 53 FPS 但功耗 51.1W 相對高了些。

另一個展示則是 Lunar Lake（下圖右）對比上一代 Meteor Lake（下圖左）筆電，使用生產力測試工具來記錄平台的功耗狀況。

新一代 Lunar Lake（下圖）功耗在閒置時約在 10W 左右，執行時平均約在 20W 左右。至於 Meteor Lake（下下圖）在閒置時與執行運算時的功耗都相對較高。

對於 Intel 來說能在內顯 GPU 的遊戲效能贏過 AMD 已經非常值得稱讚，更厲害的是功耗表現也比 Qualcomm 的 X1E-800-100 還要低了些。

現場實際接觸筆電也發現 Lunar Lake 的溫度相比 Meteor Lake 再低一些，整體功耗、續航表現都比上一代出色，也可輕鬆的贏過 Qualcomm 與 Ryzen 的筆電。

新一代 Lunar Lake 筆電即將在 9/24 日推出，喜愛輕薄、商務筆電的用戶可稍微關注下日後的效能測試。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

英特爾力拚 AI PC 市場，Core Ultra 200V 系列產品本月上架

2024-09-04 / 科技新報 / Atkinson

<https://technews.tw/2024/09/04/intel-core-ultra-200v-series-hits-shelves-this-month/>

英特爾 4 日宣布，推出 Core Ultra 200V 系列處理器，效能卓越、突破性能耗效率、大幅提升的繪圖處理效能、優異應用程式相容性、強化安全性，以及無可比擬的 AI 運算能力。

英特爾表示，新一代 Intel Core Ultra 處理器將驅動來自全球超過 20 家合作夥伴、超過 80 款業界最完整且功能強大的 AI PC 設計，合作夥伴包括宏碁、華碩、戴爾科技、惠普、聯想、LG、微星科技與三星等，其搭載新一代 Intel Core Ultra 處理器的 AI PC 即日起開放預購，9 月 24 日起將在全球 30 多家零售及線上通路上架與銷售。

英特爾執行副總裁暨 PC 客戶運算事業群總經理 Michelle Johnston Holthaus 表示，英特爾最新 Core Ultra 處理器為行動 AI 和繪圖處理效能建立了產業標竿，打破大眾對於 x86 架構效率的誤解。唯有透過英特爾與 ISV 和 OEM 的合作，以及更廣泛的技術生態系，才能夠為消費者提供完美的 AI PC 體驗。

英特爾強調，現在的消費者越來越傾向隨時隨地進行創作、連線、遊戲和學習，因此更需要一個能提供卓越效能、長效電池續航力、高度應用程式相容性及強化安全性的系統。此外，該系統還能透過廣泛軟體支援發揮 AI 硬體優勢。因此，Intel Core Ultra 200V 系列處理器在設計上充分考量到這一切，為 AI PC 提供領先的低功耗效能，可降低功耗最高達 50%。CPU、GPU 和 NPU 的總平台運算可達到 120 TOPS，在不同模型和引擎上提供最相容、效能最高的 AI 體驗。

另外，第四代 NPU 的效能相較前一代提升 4 倍，可執行連續的 AI 工作負載，同時保持高能源效率。此外，英特爾也透過 AI PC 加速計畫與全球超過 100 家獨立軟體供應商（ISV）及開發者合作，推出逾 300 種的 AI 加速功能。而新的處理器提供高效且卓越的核心效能，運用微調的電源管理、針對單位面積效能最佳化且全新設計的效能核心（P-core），以及英特爾迄今最強大的效率核心（E-core），可在低溫、安靜的狀態下支援更多工作負載。

至於在 GPU 部分，Intel Core Ultra 200V 系列處理器首度採用英特爾全新 Xe2 繪圖微架構，大幅提升行動繪圖效能，平均效能提升 30%。內建的 Intel Arc GPU 具備多達 8 個第二代 Xe 核心、8 個增強型光線追蹤單元、可支援最高 3 個 4K 顯示器，以及高達 67 TOPS 的全新內建Intel XMX（Intel Xe Matrix Extensions）AI 引擎，透過增強的 XeSS 核心，為創意型應用程式提供動力，並提升遊戲效能。

英特爾進一步強調，優異的 AI PC 必須具備絕佳效能，Intel Core Ultra 200V 系列處理器將驅動優秀的生產力效能，每執行緒效能最高可提升 3 倍，峰值效能提升 80%，電池續航力則長達 20 小時。這些出色的效能表現代表 AI PC 的全新進化。透過與領先ISV的合作、廣泛的生態系支援以及超過 500 種最佳化 AI 機型，搭載新一代 Intel Core Ultra 處理器的 PC 擁有多個效能優異的 AI 引擎，可讓使用者充分利用。

(首圖來源：英特爾)

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

英特爾絕地反攻 最新AI處理器承諾3個「最」

2024-09-04 / 自由時報 / 吳孟峰

<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4789947>

柏林消費電子展IFA 2024上，英特爾發布了一項重大公告，推出基於Lunar Lake架構的最新處理器Intel Core Ultra 200V，試圖挑戰蘋果和高通。這款新產品標誌一項關鍵進步，不僅承諾提高性能，而且還提供極卓越的能效。

英特爾做出一些大膽的宣稱，表示這些晶片不僅在幾乎所有方面都匹配，甚至超越了競爭對手。英特爾表示，新晶片在許多電池壽命和每瓦性能測試中也擊敗了其他晶片。

英特爾將於9月24日在筆記型電腦中首次亮相新處理器，並承諾透過新的Core Ultra 200V系列提供「最快的CPU核心」、「世界上最好的內建GPU」和「最佳的AI效能」。這將為筆記型電腦市場的激烈競爭奠定基礎，尤其是針對高通的Snapdragon X Elite和AMD的Ryzen AI 300。

戴爾、三星和LG將推出配備英特爾全新Core Ultra 處理器（系列 2）的新筆記型電腦型號，包括XPS 13、Galaxy Book5 Pro 360 和 LG Gram 16。

Core Ultra 200V 列之前的代號為Lunar Lake已掀起電源革命，Lunar Lake架構代表其前身Meteor Lake的重大演變，借助它英特爾將CPU核心和高速緩存的數量增加一倍 ，此舉旨在提高處理能力和效率。

除了CPU之外，英特爾在增強GPU（圖形處理單元）和 NPU（神經處理單元）單元方面也取得了重大進展。該公司報告稱，與上一代相比，AI效能提高了58% ，凸顯AI處理在現代運算任務中日益重要。

此外，據報導，GPU的遊戲表現足以與領先的替代品競爭，這可能使Core Ultra 200V成為休閒遊戲玩家和內容創作者的有吸引力的選擇。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

Intel 發表新一代 AI 處理器 Core Ultra 200V 系列：更高效能、更低能耗

2024-09-04 / 電獺少女

<https://agirls.aotter.net/post/63550>

如果你有在關注電腦市場，應該會知道今年 Intel 出了大事，最新的 13、14 代高階處理器因為設定電壓有誤導致大量發生縮缸問題，從前幾年的 Intel Yes，變成現在急需一顆定心丸的狀況，而就在 9/4（三） 凌晨，Intel 發布了最新一代 AI 處理器 Intel Core Ultra 200V 系列 Lunar Lake，究竟這新處理器能不能拯救 Intel 的頹勢力挽狂瀾呢？就讓我們繼續看下去！

全面升級的 Intel Core Ultra 200V 系列

在開始介紹新品之前先讓小編偷臭一下，堂堂 Intel 拜託處理一下自家的直播好嗎，不只畫面會卡頓延遲、影音還會不同步，最痛苦的是會進入回溯輪迴，整場發佈會觀看體驗真的很痛苦，不能乾脆點直接用 YouTube 直播就好嗎...

OK，回歸正題，這次新發布的 Intel Core Ultra 200V 系列是專為輕薄筆電設計，這次 Intel 在維持小體積的同時，繼續加強了晶片的效能

透過針對效能調整的 Lion Cove P 核心，以及針對效率調整的 Skymont E 核心兩種類型的核心架構

複雜的術語我們省略，大家只要知道，E-Core 節能核心能在相同功耗發揮更高運算效能，P-Core 效能核心則能更進一步提升整體運算效能就好

這兩者相輔相成的成果就是，在提升效能的同時，卻能大大減少能耗，而且 Intel 不只跟自家上一代處理器比，還跟高通比，效能更好，能耗卻少 53%，真的很扯

同時提升的還有內顯核心的效能，無論是刺客教條還是 Cyberpunk 2077，都能看出效能顯著提升能耗卻降低

且在執行 UL Procyon Office Productivity 測試續航力時，可達到 20 小時的超長續航

同時 Intel 依然不忘鞭一下隔壁的 AMD 和高通，說自家的內顯比它們還強（雖然我想 Intel 可能忘記普遍遊戲玩家玩遊戲時都是搭配獨立顯卡），對於輕度遊戲玩家而言是個好選擇唷

不過在發佈會上的實測影片倒是能很明顯展示新一代 Intel 處理器的優勢，這功耗真的低很多

不過說到 AI 處理器，最後要看的當然還是算力的部分，不知道算力是什麼的請搭配小編之前介紹的文章（TOPS 是什麼？）服用唷！

Intel Core Ultra 200V 最高可達到 120 TOPS，分別由 GPU 提供 67 TOPS 、NPU 提供 48 TOPS 、CPU 提供 5 TOPS

在生成圖片測試中，無論是 GPU 還是 NPU 運算都比高通還要快

看得出來 Intel 被縮缸事件搞到怕了，整個發佈會一直在強調能耗的部分，這次應該不會再有為了催效能而把電壓加強的問題

此外發佈會最後 Intel 也透漏已經積極與各大品牌合作，無論是軟體還是硬體夥伴，接下來都能陸續看到合作產品推出唷！小編私心最期待的是新的遊戲掌機系列，好欸！

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

英特爾推 Core Ultra 200V 處理器，聲稱「將打破大眾對 x86 效率的誤解」

2024-09-04 / Inside / Sisley

<https://www.inside.com.tw/article/36102-intel-core-ultra-200-v>

英特爾推出截至目前為止最高效率、基於 x86 架構的 Intel Core Ultra 200V 系列處理器，宣稱「將打破大眾對於 x86 架構效率的誤解」！

Intel 推出 Core Ultra 200V（Lunar Lake）系列處理器，這是一款針對競爭對手 Qualcomm 和 AMD 最新筆電晶片的產品。Intel 宣稱，新系列在 CPU、 GPU 和 AI 效能方面都領先對手，同時兼顧電池續航力，將有 80 款 AI PC 將採用這款晶片並將於本週推出。

例如 Dell 新款 XPS 13 筆電採用 Lunar Lake 處理器，就聲稱在相同硬體配置下，播放 Netflix 的電池續航力從 18 小時提升至 26 小時。Intel 還表示，其新晶片在遊戲效能上大幅領先 Qualcomm ，甚至超越 AMD ，其 Core Ultra 9 288V 的平均影格率比 Samsung Galaxy Book4 Edge 中的 Qualcomm X1E-84-100 高出 68% ，比 Asus Zenbook S 16 中的 AMD HX 370 晶片高出 16% 。

根據 Intel 的說法，若啟用 XeSS 技術，即使是光線追蹤遊戲也能順暢運行，例如《電馭叛客 2077》可達 45fps 、《漫威蜘蛛人重製版》可達 57fps ，以及《古墓奇兵：暗影》可達 66fps 。（不過，Intel 並未提供這些光線追蹤遊戲的具體解析度和畫質設定。）

其他的合作夥伴還包括：宏碁、華碩、惠普、聯想、LG、微星與三星。

英特爾執行副總裁暨 PC 客戶運算事業群總經理 Michelle Johnston Holthaus 表示，這款處理器為行動 AI、繪圖處理效能建立了產業新標竿，將打破大眾對於 x86 架構效率的誤解。

根據 Intel 的官方說法，搭載新一代 Intel Core Ultra 處理器的 PC 擁有多個效能優異的 AI 引擎，新處理器 CPU、GPU 和 NPU 的總平台運算可達到 120 TOPS其中，第四代 NPU 的效能相較前一代提升 4 倍，可執行連續的 AI 工作負載，同時保持高能源效率。可讓使用者充分利用以下 AI 功能：

Lunar Lake 筆電應該具備出色的內建連接能力：Wi-Fi 7 、 Bluetooth 5.4，以及至少兩個 Thunderbolt 4 埠，並最多支援三個 4K 螢幕。

不過，要注意的是，Lunar Lake 僅適用於 RAM 不超過 32GB 的輕薄筆電，晶片也無法進行後續升級，如果消費者在等待擁有更多核心、更大 RAM 容量的 Intel 筆電，則需要等待 Intel 的 Arrow Lake 系列，可能最快在 10 月 10 日推出。

搭載新一代 Intel Core Ultra 處理器的 AI PC 即日起開放預購，9 月 24 日起將在全球 30 多家零售及線上通路上架與銷售。不過，部分 AI 功能如 Copilot Plus 將於 11 月才能透過更新使用。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

Lunar Lake全由台積電製造　英特爾還需留晶圓代工？

2024/09/05 / 電子時報 / 楊智家

<https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?id=0000701687_3KN5612A9951SL6QRJZX3&packageid=59140&cnlid=1&cat=40&wpidx=6>

英特爾（Intel）在本屆德國IFA展前，發表代號Lunar Lake的Core Ultra 200V系列處理器，但Lunar Lake是英特爾首款所有邏輯晶片都由外部晶圓代工廠商、即台積電製造的處理器設計。

對此市場分析認為，那英特爾何須發展自有晶圓代工業務？但其他論點認為，市場上對英特爾晶圓代工仍存有需求性，若少了英特爾，台積電、三星電子（Samsung Electronics）並無足夠產能，支持英特爾晶圓製造量能全面撤出市場。

據FierceElectronics報導，市場分析，儘管外界對Lunar Lake持樂觀態度，但Lunar Lake的晶片塊（tile）、包括中央處理器（CPU）在內，均由台積電代工製造，這既令英特爾尷尬，英特爾利潤表現也不會好。

台積電以3奈米製程製造Lunar Lake的運算模組，並以6奈米製程製造Lunar Lake的平台控制模組，成為英特爾首個所有邏輯晶片，均由外部晶圓代工廠製造的處理器設計。

市場分析認為，英特爾沒有為其18A製程節點找到旗艦客戶、未儘早進入行動領域，加上沒有足夠快進入人工智慧（AI）領域，從而如今未能在AI晶片領域成為NVIDIA和超微（AMD）有力競爭對手，成為英特爾這幾年來的遺憾與敗筆。

市場分析甚至認為，英特爾晶圓代工廠沒有基於市場的理由存在，部分原因在於台積電在台灣進行了所有全球所需先進製程節點的生產。

至於在台灣生產晶片面臨的中美地緣衝突風險問題，部分市場觀點甚至認為，美國應該創建一個新的晶圓代工實體，而不是押寶於英特爾來生產具有美國政府採購保證的晶片，因不是x86架構晶片、且可避免英特爾的低效率。英特爾4月稱其晶圓代工業務在2023年虧損70億美元，比2022年的50億美元虧損額度再擴大。

對英特爾來說，晶圓製造擴張也面臨成本困境。據路透（Reuters）報導，由於英特爾尋求節省成本，將考慮暫停或停止位於德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）的300億歐元（約330億美元）投資規模新晶圓廠建廠計畫。

Bits & Chips報導，由於失去技術領先地位，並缺乏規模來跟上保持領先地位所需的大量投資，英特爾目前正處於水深火熱。英特爾執行長Pat Gelsinger似乎不可避免必須縮減他於2021年啟動的計畫，以在技術和產能方面迎頭趕上。最近，英特爾已宣布一項100億美元的成本節約計畫，其中包括裁員15%。

但市場上另有觀點認為，英特爾目前的晶片在市場上發揮重要作用，如仍囊括80%的NB和PC的CPU市佔，以及有70%資料中心採用英特爾Xeon CPU。

Moor Insights & Strategy創辦人兼分析師Patrick Moorhead表示，即使面對英特爾晶圓代工的巨大擔憂，台積電和三星也沒有足夠產能支持英特爾的全面崩潰，這將對全球PC和資料中心晶片的全球供應造成數年影響。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

英特爾又爆危機！最先進製程遭批「良率不佳」 賣相打折

2024-09-05 / 中時新聞網 / 郭宜欣

<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240905001680-260410?chdtv>

英特爾為了拯救糟糕的營運狀況，考慮分拆晶圓代工業務，但目前談判仍處在早期階段，尚未有進一步消息。雪上加霜的是，路透社披露，英特爾最先進的18A製程經過通訊大廠博通測試後，出現良率不足難以量產的狀況，再次打擊英特爾的士氣。

路透社引述3位消息人士的說法指出，博通8月收到英特爾代工的晶圓後進行測試，但結果讓他們對18A製程產生疑慮，良率並沒有達到標準無法進入量產階段。目前無法確認雙方的合作關係，以及博通是否會再給英特爾機會。

博通低調回應此事，強調公司正在評估英特爾晶圓代工的產品，尚未得出結論。英特爾則強調，18A製程運作順利，有信心在2025年大量生產，且市場對此產品有高度興趣。

無論如何，此消息一出仍讓英特爾的形象受傷，晶圓代工業務不僅虧損嚴重，技術能力也會面臨質疑，可能影響到分拆時的賣相。知名半導體分析師陸行之曾指出，英特爾晶圓代工的營業虧損率為-65%，即使想要免費送給別人，也真的是誰接誰燙手。

英特爾號稱18A技術優於台積電3奈米，但研調機構Redefine Innovation數據指出，台積電3奈米的電晶體密度優於英特爾，要大幅超越台積電3奈米不太可能。台積電總裁魏哲家也曾表示，3奈米效能比英特爾18A好。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

Intel 展示 Lunar Lake 生產力與遊戲功耗的出色表現

2024-09-04 / XFastest / lin.sinchen

<https://www.xfastest.com/thread-291874-1-1.html>

Intel 新一代 Core Ultra 200V 筆電處理器、代號 Lunar Lake，為 AI PC 時代帶來突破性效能和效率提升，並在全球發表會中實際展示筆電在生產力測試與遊戲時的功耗表現對比。

實際展示中 Intel 使用 Core Ultra 9 288V、Core Ultra 7 258V、HX 370 與 X1E-80-1000 等 4 台筆電，執行 Dota 2 遊戲並記錄 FPS 與功耗表現。

Core Ultra 9 288V 可達到 78 FPS 僅 43.2W 功耗、Core Ultra 7 258V 則是 72 FPS 僅 34.2W 功耗，而比較的 HX 370 則是 63 FPS、47.1W 功耗至於 X1E-80-100 僅只有 53 FPS 但功耗 51.1W 相對高了些。

另一個展示則是 Lunar Lake（下圖右）對比上一代 Meteor Lake（下圖左）筆電，使用生產力測試工具來記錄平台的功耗狀況。

新一代 Lunar Lake（下圖）功耗在閒置時約在 10W 左右，執行時平均約在 20W 左右。至於 Meteor Lake（下下圖）在閒置時與執行運算時的功耗都相對較高。

對於 Intel 來說能在內顯 GPU 的遊戲效能贏過 AMD 已經非常值得稱讚，更厲害的是功耗表現也比 Qualcomm 的 X1E-800-100 還要低了些。

現場實際接觸筆電也發現 Lunar Lake 的溫度相比 Meteor Lake 再低一些，整體功耗、續航表現都比上一代出色，也可輕鬆的贏過 Qualcomm 與 Ryzen 的筆電。

新一代 Lunar Lake 筆電即將在 9/24 日推出，喜愛輕薄、商務筆電的用戶可稍微關注下日後的效能測試。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

英特爾新處理器放棄自家製程　外媒曝：可能轉包台積電

2024-09-05 / ETtoday / 高兆麟

<https://finance.ettoday.net/news/2811138>

根據外媒Tom’s Hardware報導，英特爾今天宣布，它不再計劃在即將推出 Arrow Lake 處理器中使用自己的「Intel 20A」製程。相反，它將使用外部製程，據傳可能來自合作夥伴台積電來生產 Arrow Lake 的所有晶片組件。英特爾對 Arrow Lake 處理器的唯一製造責任是將外部製造的小晶片封裝到最終的處理器中。

這項消息發布之際，英特爾因上季財務表現令人擔憂而開始進行大規模重組，英特爾繼續裁員 15,000 名員工，這是其 56 年歷史上最大的裁員。

英特爾在其 Innovation 2023 活動上首次演示了在 20A 製程上製造的 Arrow Lake 處理器晶圓，這表明該晶片已經處於開發週期中。當時，英特爾表示 Arrow Lake 將於 2024 年上市。

英特爾表示，其關鍵的下一代「英特爾 18A」製程仍有望在 2025 年推出。英特爾再次指出，18A 的 D0 缺陷密度已低於 0.40，這是衡量製程良率的關鍵指標。一旦 D0 達到 0.5 或更低，製程節點通常被認為具有生產價值且運作良好。

看來英特爾現在將完全超越其 20A 製程，並避免將其全面投入生產所需的資本支出。消除新製程總是令人瞠目結舌的成本，肯定有助於公司實現其成本削減目標。

英特爾 20A 製程從未計劃用於多數產品，因為英特爾在努力實現四年內交付 5 個製程的目標時，快速轉向更先進的 18A 製程，因此建立廣泛的 20A 生產回報有限。然而，英特爾的 20A 成為了多項新進步的載體，例如  RibbonFet Gate-All-Around (GAA ) 技術，這是自 2011 年 FinFET 推出以來英特爾的第一個新晶體管設計。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

搶攻伺服器市場！華碩啟動「All in AI計畫」　提供全方位AI解方

2024-09-03 / ETtoday / 楊絡懸

<https://finance.ettoday.net/news/2810115>

華碩（2357）3日宣布，啟動「All in AI計畫」，將以全方位的AI基礎設施解方進軍伺服器市場，包括從邊緣運算、推論及生成式AI，滿足AI驅動應用領域不斷演進的多元需求。

華碩指出，憑藉數十年來的研發經驗，在硬體與軟體間取得平衡，如基礎架構／叢集架構設計、伺服器安裝、測試、上架、遠端管理與雲端服務，使華碩與AI伺服器解決方案得以領先推動創新，實現AI在各產業中的廣泛應用。

華碩也攜手輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）與超微（AMD）等合作夥伴攜手，提供一應俱全的AI基礎設施解方，兼備強大的軟體平台與服務，像是入門級AI伺服器、機器學習解決方案，以及用於大規模超級運算的完整機架和資料中心。

其中，華碩配備NVIDIA GB200 NVL72的ESC AI POD，採用專為加速兆級位元LLM訓練、即時推論運作的機架式設計，並搭載最新NVIDIA Blackwell GPU、NVIDIA Grace CPU，還有第5代NVIDIA NVLink技術，將帶來極致運算及效率。

至於生成式AI方面，華碩也推出應有盡有的8 GPU系列產品，包括最新的NVIDIA Blackwell HGX、AMD MI300X和Intel Gaudi 3解決方案。這些產品均採用可擴充式模組化架構，能因應數位雙生、高效能運算（HPC）工作負載、AI基礎設施供應，以及雲端遊戲與服務。

華碩強調，整合式AI平台與軟體具有快速自訂、部署於各種應用場域的功能，短短8周即能完成標準的資料中心軟體解決方案。

另在AI超級運算領域，華碩已在多個世界級計畫中表現亮眼，包括台灣杉二號（Taiwania 2）、創進一號（Forerunner 1）等，其中，超級電腦前進一號能源效率達1.17，展現出永續發展的努力。未來將期盼此次AI全系列伺服器的推出，為各行各業提供加速研發的基礎。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

台積電：AI 主導未來半導體市場，A16 製程＋12 個 HBM4 設計 2027 年推出

2024-09-04 / 科技新報 / Atkinson

<https://technews.tw/2024/09/04/ai-dominates-future-advanced-packaging-development/>

台積電營運及先進封裝技術暨服務副總經理何軍表示，3DIC 是達成 AI 晶片記憶體與邏輯晶片整合的重要方式。就目前採八個小晶片整合的 2.5D CoWoS 先進封裝來說，採 A16 先進製程，加上 12 個 HBM4 高頻寬記憶體，2027 年推出。

何軍在 Semicon Taiwan 2024「3D IC / CoWoS 驅動 AI 晶片創新論壇」演講，市場估全球半導體產業 2030 年達兆美元，最重要驅動力就是 HPC 與 AI，占比達 40%，領先手機 30%、汽車 15%、物聯網與其他的 15% 與 5%。台積電 3DIC 產能已爆發式成長滿足客戶需求。何軍開玩笑說，簡報不敢列出台積電 CoWoS 成長數據，因一直被客戶追著要產能。

為什麼客戶要選擇小晶片（Chiplet）和 3DIC 的方式來做 AI 晶片，其原因就在於有較低的擁有成本與較少的設計轉移負擔。何軍舉例，如果設計是將原本的 SoC+HBM 的設計架構、轉換為小晶片與 HBM 的架構下，因為除了新設計的邏輯晶片之外，其他的 I/O、SoC 方面都可沿用舊製程的晶片，使得其量產成本將降低到 76%。即便新架構的生產成本提高 2%，但在這一來一往的情況下，達到提升 22% 擁有成本的效果。

不過，3DIC 仍然有所挑戰，其關鍵就在於如何提高產能方面。何軍強調，要能使 3DIC 能夠提高產能，其關鍵就在整個晶片的大小與製程複雜度上。先就晶片大小來說，越大晶片就能夠放下越多的小晶片在其中，達到越好的效能，但相對的製程技術就會越來越複雜，複雜度會達 3 倍，還要面臨晶片移位、斷裂、擷取失敗的風險挑戰。

為了解決這樣的風險挑戰，何軍指工具自動化與標準化、過程的控制與品質、加上 3DFabric 製造平台的幫助是三大主要關鍵。其中、在工具自動化與標準化方面，台積電的工具供應商能力是差異化的關鍵。因此，在台積電 64 家供應商加入的情況下，台積電開始有主導先進封裝工具的能力。至於，過程的控制與品質就由高解析度的 PnP 工具、加上 AI 帶動的品質管控，使台積電能有強大全面的品質管理。最後，透過 3DFabric 製造平台來整合供應鏈 1,500 種材料，達到優化效果。

何軍最後表示，因為台灣有非常非常強大的供應鏈生態系，使得台積電在先進封裝上的發展快速進步。以 2015 年台積電建立一個封裝廠到最後可以量產的時間約要 5 年之久，到現在加上政府的大力支持，只需要不到兩年的情況下就能完成，藉以滿足市場客戶激增的需求。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

未來藍圖要角！台積電重心逐步往 CoWoS-L 邁進

2024-09-04 / 科技新報 / 林妤柔

<https://technews.tw/2024/09/04/tsmc-semicon-taiwan-2024-cowos-l/>

台積電高效能封裝整合處處長侯上勇 3 日在 Semicon Taiwan 2024 專題演講，表示視為三種 CoWoS 產品，能滿足所有條件的最佳解決方案，因此會從 CoWoS-S 逐步轉移至 CoWoS-L，並稱 CoWoS-L 是未來藍圖要角。

侯上勇指出，台積電過去的三場演講，於 2012 年發表 3D-IC 模組、TSV、微凸塊（micro bond）和臨時載板製程；2016 年第二次講座，重點是 HBM 邏輯整合；2020 年第三場則確定矽中介層可擴展三倍光罩尺寸；現在則是第四個講座的最佳時機。

侯上勇認為，由於頂部晶片（Top Die）成本非常高，CoWoS-L 是比 CoWoS-R、CoWoS-S 更能滿足所有條件的最佳解，且因為具有靈活性，可在其中介層實現異質整合，會有其專精的尺寸與功能。

他提到，CoWoS-L 可相容於各式各樣的高效能頂級晶片，例如先進邏輯、SOIC 和高頻寬記憶體。

此外，台積電也根據整體系統散熱方案開發各種散熱解決方案，而共同封裝光學（CPO）開發工作也在進行中。侯上勇指出，在 CoWoS 封裝中使用光學引擎（COUPE）的 CPO，將使每瓦效能達到新里程碑。他也提到 SOW（System-on-Wafer）技術，表示過去已經用於特斯拉，公司也在幫 Cerebras 代工的 wafer level chip。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─

台積電副總裁相信人工智慧可以將半導體收入推至1兆美元

2024-09-05 / XFastest / sxs112.tw

<https://www.xfastest.com/thread-291904-1-1.html>

台積電探路與企業研究副總裁曹敏博士認為人工智慧晶片的需求將推動全球半導體產業的收入將在2030年達到1兆美元。 。這位台積電高層在演講中表示自1987 年公司成立以來，每十年左右就會出現一波新的科技浪潮。

這些涵蓋個人電腦、智慧型手機和汽車的浪潮增加了收入基礎。他表示最新的技術浪潮是人工智慧晶片，這將推動高效能運算（HPC）晶片的需求達到新高。

台積電高層在演講中表示當今推動人工智慧產業發展的三大技術是先進封裝、先進邏輯技術和先進記憶體。這三項技術都是製造人工智慧晶片的關鍵，因為邏輯技術負責製造人工智慧處理器，而儲存晶片與處理器一起工作，使它們能夠計算大量數據，而封裝則需要將晶片組裝成最終的產品。

這位台積電高管於2002年開始在該公司的職業生涯，一直致力於從90nm到10nm的製程技術，他補充說到2024年半導體產業將累計獲得6,000億美元的收入。該行業形成了晶片是現代生活的基石，廣泛應用於汽車、醫療設備、5G 通訊、人工智慧、高效能運算和其他應用。

台積電官員補充稱從2024年6,000億美元營收預估來看，到2030年半導體市場總規模可成長至1兆美元。創歷史新高。然而由於投資者繼續關注人工智慧的潛力以及在不確定的經濟環境下高成本和盈利不佳的風險，該股自6月高點以來已下跌約20%，這使得NVIDIA成為全球最有價值的公司。

曹博士估計的1兆美元按大小順序包括對人工智慧產品、智慧型手機、汽車晶片和物聯網 (IoT) 小工具的需求。他認為到2030年包括人工智慧晶片在內的高效能運算產品將佔半導體產業1兆美元收入的40%。

台積電2024年第一季、第二季營收為397.8億美元。第二季HPC產品不僅占公司營收的52%，也是成長最快的市場，較上季成長率高達28%。第一季HPC佔台積電營收的46%，比2023年第一季44%提升了兩個百分點。

[-Top-](#TOP)

─ ─ ─ ─